



原證券代號：231949

興櫃代號：R133

股票代號：6213

# 聯茂電子股份有限公司

## ITEQ CORPORATION

### 簡式公開說明書

(發行九十二年度第一次有擔保普通公司債用)

一、本公開說明書編印目的係為本公司發行九十二年度第一次有擔保普通公司債之用，其有關事項如下：

- (一)發行種類：銀行擔保普通公司債。
- (二)債券名稱：聯茂電子股份有限公司九十二年度第一次有擔保普通公司債(下稱「本公司債」)
- (三)發行總額：發行總額為新台幣壹億元整。
- (四)票面金額：新台幣壹佰萬元整壹種，共壹佰張。
- (五)發行期間：發行期間為五年。
- (六)保證銀行：由交通銀行股份有限公司保證發行。
- (七)發行價格：依本公司債面額十足發行。
- (八)票面利率：利率為1.35%。
- (九)付息方式：自發行日起，每年依票面利率單利計、付息一次。
- (十)還本方式：於發行後屆滿三、四、五年分別還本30%、30%、40%。
- (十一)公開承銷比例：不適用。
- (十二)承銷及配售方式：未委託證券承銷商對外公開承銷。

二、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請參閱本文第34頁。

三、有價證券之生效(准)不得藉以作為證實申報(請)項或保證證券價值之宣傳。

四、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

五、財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。

六、本公開說明書查詢網址：[www.mops.tse.com.tw](http://www.mops.tse.com.tw)

聯茂電子股份有限公司 編製

中華民國九十二年六月二十四日 刊印

## 一、本次發行前實收資本之來源及比率

資本來源	金額(新台幣仟元)	佔實收資本額比率
創立股本	220,000	27.11%
現金增資	430,000	52.99%
盈餘轉增資	117,450	14.48%
資本公積轉增資	43,990	5.42%
員工紅利轉增資	--	--
合計	811,440	100.00%

## 二、公開說明書之分送計畫

1. 陳列處所：本公司及股務代理機構、各證券商營業處所、台灣證券交易所、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會。
2. 分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之規定方式辦理。
3. 索取方式：請附回郵信封向本公司或股務代理機構索取或透過網路(<http://mops.tse.com.tw>)取閱。

## 三、公司債承銷商：無。

## 四、公司債保證機構：

名稱：交通銀行股份有限公司 網址：[www.ctnbank.com.tw](http://www.ctnbank.com.tw)  
地址：台北市衡陽路 91 號 電話：(02) 2361-3000

## 五、公司債受託機構：

名稱：萬通商業銀行總行信託部 網址：[www.grandbank.com.tw/](http://www.grandbank.com.tw/)  
地址：台北市忠孝東路四段 560 號 2 樓 電話：(02)2723-7890

## 六、公司債簽證機構

名稱：交通銀行股份有限公司 網址：[www.ctnbank.com.tw](http://www.ctnbank.com.tw)  
地址：台北市衡陽路 91 號 電話：(02) 2361-3000

## 七、辦理公司債過戶機構

名稱：聯茂電子股份有限公司 網址：[www.iteq.com.tw](http://www.iteq.com.tw)  
地址：桃園縣平鎮市工業區工業一路 22 號 電話：(03) 419-2345

## 八、信用評等機構：無。

## 九、公司債簽證會計師及律師：

簽證會計師：林秀玉、王明志  
事務所名稱：安侯建業會計師事務所 網址：[www.kpmg.com.tw](http://www.kpmg.com.tw)  
地址：台北市民生東路三段 156 號 6 樓 電話：(02) 2715-9999

簽證律師：郭惠吉  
事務所名稱：現代法律事務所 網址：無  
地址：台北市新生南路二段 82 號 3 樓之一 電話：(02) 2392-0628

## 十、最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：林秀玉、王明志  
事務所名稱：安侯建業會計師事務所 網址：[www.kpmg.com.tw](http://www.kpmg.com.tw)  
地址：台北市民生東路三段 156 號 6 樓 電話：(02) 2715-9999

## 十一、本公司發言人及代理發言人姓名、職稱、電話及電子郵件信箱

發言人姓名：高繼祖 電子郵件信箱：[michael@mail.iteq.com.tw](mailto:michael@mail.iteq.com.tw)  
職稱：總經理 電話：(03)419-2345  
代理發言人姓名：吳家宗 電子郵件信箱：[jackson\\_wu@mail.iteq.com.tw](mailto:jackson_wu@mail.iteq.com.tw)  
職稱：財務處處長 電話：(03)419-2345

## 十二、公司網址：[www.iteq.com.tw](http://www.iteq.com.tw)

聯茂電子股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 811.44 佰萬元	公司地址：桃園縣平鎮市工業一路 22 號	電話：(03)419-2345
設立日期：86 年 4 月 10 日	網址：www.iteq.com.tw	
上市日期：—	上櫃日期：91 年 12 月 30 日	公開發行日期：86 年 10 月 4 日
管理股票日期：—		
負責人：董事長：萬海威 總經理：高繼祖	發言人：(姓名)高繼祖 (職稱)總經理	代理發言人：(姓名)吳家宗 (職稱)財務處處長
債券過戶機構：聯茂電子股份有限公司	電話：(03) 419-2345 網址：www.iteq.com.tw 地址：桃園縣平鎮市工業區工業一路 22 號	
債券承銷機構：無		
最近年度簽證會計師：林秀玉、王明志	電話：(02) 2715-9999 地址：台北市民生東路三段 156 號 6 樓	網址：www.kpmg.com.tw
信用評等機構：—	電話：— 地址：—	網址：—
最近一次經信用評等日期：—	評等標的：—	評等結果：—
董事選任日期：89 年 6 月 16 日	任期 3 年	監察人選任日期：89 年 6 月 16 日
		任期 3 年
全體董事持股比率：13.08% (92 年 2 月 28 日)	全體監察人持股比率：2.55% (92 年 2 月 28 日)	
董事、監察人及持股 10%以上股東及其持股比率：(92 年 2 月 28 日)		
職稱	姓名	持股比例
董事長	萬海威	2.02%
董事	高繼祖	1.53%
董事	黃琇卿	1.14%
董事	徐超俊	3.47%
職稱	姓名	持股比例
董事	寰邦投資(股)公司	2.63%
董事	和通創業投資(股)公司	1.09%
董事	樺彩(股)公司	1.21%
董事	馬君梅	--
監察人	白蓉生	--
監察人	洪振攀	0.70%
監察人	寶聚投資(股)公司	1.85%
監察人	宋同慶	--
工廠地址：桃園縣平鎮市工業一路 22 號	電話：(03)419-2345	
主要商品：玻璃纖維膠片、銅箔基板、多層壓合基板	參閱本文之頁次	
市場結構：內銷：43.56% 外銷：56.44%	無	
本(92)年度預估	營業收入： 製造業：2,383,206 仟元 稅前純益：123,825 仟元	每股盈餘：1.22 元 41 頁
去(91)年度	營業收入：1,713,287 仟元 製造業：1,713,287 仟元 稅前純益：102,295 仟元	每股盈餘：1.03 元 41 頁
本次募集發行有價證券種類及金額	九十二年度第一次有擔保普通公司債 100,000,000 元	
發行條件	請參閱本公開說明書封面	
募集資金用途及預計產生效益概述	請參閱本公開說明書第 34 頁	
本次公開說明書刊印日期：92 年 6 月 24 日	刊印目的：發行九十二年度第一次有擔保普通公司債	
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：略		

## 目錄

	頁次
壹、公司概況	4
一、公司簡介	4
二、公司組織	5
三、資本及股份	10
四、員工分紅及董事、監察人酬勞	12
貳、營運概況	13
一、公司之經營	13
二、固定資產及其他不動產	28
三、轉投資事業	29
四、重要契約	30
五、營運概況其他必要之補充說明事項	31
參、發行計畫及執行情形	32
一、本次發行公司債資金運用計畫分析	32
(一)資金來源	32
(二)本次發行公司債應依公司法248 條之規定揭露有關事項	32
(三)本次計畫之可行性、必要性及合理性，並分析各種資金調度來源對公司申報(請)度及未來一年每股盈稀釋影響	33
(四)資金運用概算及可能產生效益	34
肆、財務概況	38
一、最近五年度簡明財務資料	38
二、財務報表	40
三、財務概況其他重要事項	43
四、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理	43
伍、特別記載事項	48
一、內部控制制度執行狀況	48
二、信用評等機構出具之評等報告	48
三、證券承銷商評估總結意見	48
四、律師法律意見書	48
五、發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	48
六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經證期會通知應補充揭露之事項	48
七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容	48
八、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施	48

# 壹、公司概況

## 一、公司簡介

(一) 設立登記日期：民國八十六年四月十日

(二) 總公司、分公司及工廠之地址及電話：

總公司地址：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業一路22號

電話：(03) 419-2345

工廠地址：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業一路22號

電話：(03) 419-2345

(三) 公司沿革：

民國 86 年 聯茂電子成立，登記資本額貳億貳仟萬元。主要產品係多層印刷電路板  
基材及銅箔基板半成品、成品之製造、加工及買賣。

辦理現增壹億元，總資本額增至參億貳仟萬元。

同年十月補辦公開發行。

民國 87 年 正式量產並銷售。

獲經濟部工業局「主導性新產品開發專案」補助。

通過 BSI ISO-9002 認證合格。

民國 88 年 辦理現金增資壹億參仟萬元，總資本額增至肆億伍仟萬元。

獲經濟部工業局「業界科技專案」補助。

向台灣、日本及美國申請「用於環氧樹脂硬化劑合成」之專利審查。

完成「主導性新產品開發專案」高 Tg(180°C)產品配方並通過 UL94V 認  
證合格。

民國 89 年 通過 BSI QS-9000 認證合格。

因熱煤油儲存桶溢流導致電線走火引起火災，造成部分廠房、機器設備  
及原料毀損；經近半年復建，於同年九月完全量產，其產能及營收已超  
越火災前水準。

向西陵電子(股)公司購買桃園山仔頂段 331 地號之土地及建築物，供災  
後復建及未來營運擴充使用。

High Tg、Low DK 及 Green Laminate 取得 UL 認證。

與聯成石油化學(股)公司簽訂「股東協議書」，擬共同投資在中國大陸  
廣東省中山「聯茂科技有限公司」經營銅箔基板、膠片及多層印刷電路  
板基材之研發、製造、銷售及其相關業務。

民國 90 年 辦理現金增資壹億柒仟肆佰伍拾萬元，總資本額增至陸億貳仟肆佰伍拾  
萬元。

辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資合計捌仟陸佰玖拾肆萬元，總資本額  
增至柒億壹仟壹佰肆拾肆萬元。

獲經濟部工業局「主導性新產品開發專案」補助，第三代通訊基板用膠  
片。

發表新世代堆層法 Laser Drillable Prepreg 及高頻通訊材料。

洽商終止與聯成石化(股)公司共同投資中國大陸廣東省中山「聯茂科技  
有限公司」協議。

民國 91 年 辦理現金增資壹億元，總資本額增至捌億壹仟壹佰肆拾肆萬元。

與海外投資開發股份有限公司等簽訂「股東協議書」，擬共同投資在中國  
大陸廣東省設立「東莞聯茂電子科技有限公司」經營銅箔基板、膠片及  
多層印刷電路板基材製造、銷售及其相關業務。

公司股票掛牌上櫃

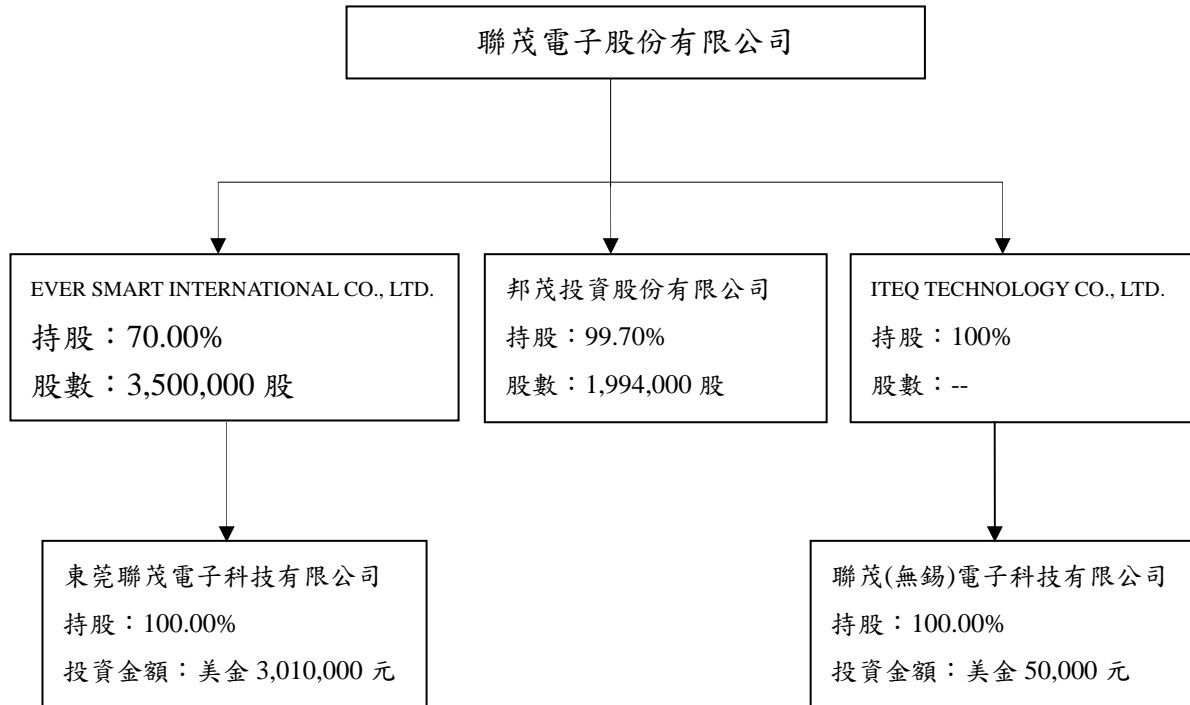
民國 92 年 發行國內第一次無擔保轉換公司債貳億元，用於購置機器設備及償還銀  
行借款。

## 二、公司組織

### (一)關係企業：

#### 1. 關係企業圖

日期：91年12月31日



#### 2. 與關係企業之關係及相互持股情形

日期：91年12月31日

單位：新台幣仟元

關係企業公司名稱	與公司之關係	持有聯茂電子股份			聯茂電子持有關係企業股份		
		股數(股)	持股比例	投資金額 (原始成本)	股數(股)	持股比例	投資金額 (原始成本)
ITEQ TECHNOLOGY CO., LTD.	本公司持有其已發行有表權之股份超過半數	0	0	0	--	100.00	3,458
邦茂投資股份有限公司	本公司持有其已發行有表權之股份超過半數	0	0	0	1,994,000	99.70	19,940
EVER SMART INTERNATIONAL CO., LTD.	本公司持有其已發行有表權之股份超過半數	0	0	0	3,500,000	70.00	122,024
東莞聯茂電子科技有限公司	本公司之子公司出資額超過其資本總額半數	0	0	0	0	0	0
聯茂(無錫)電子科技有限公司	本公司之子公司出資額超過其資本總額半數	0	0	0	0	0	0

(二) 董事及監察人

1. 主要經(學)歷、選(就)任日期等資訊

92年02月28日

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	萬海威	89.06.16	3年	590,000	1.31%	1,635,820	2.02%	--	--	美國哥倫比亞大學化工博士	邦茂投資董事長 邦茂國際監察人 普羅米數位科技監察人 隴邦科技監察人 邦英生物科技董事	—	—	—
董事	高繼祖	89.06.16	3年	320,000	0.71%	1,242,700	1.53%	846,080	1.04%	美國加州柏克萊大學化學博士	邦茂投資董事 冠緯實業董事	—	—	—
董事	黃琇卿	89.06.16	3年	750,000	1.67%	924,000	1.14%	--	--	中興大學	鴻源科技董事 普鈺科技董事	—	—	—
董事	徐超俊	90.05.25	註	2,662,967	5.92%	2,814,523	3.47%	--	--	龍華工專電子科	邦茂投資監察人 上宏科技監察人 上賦國際董事 台灣東榮電資董事	—	—	—
董事	震邦投資(股)公司 代表人：林邦充	89.06.16	3年	2,867,812	4.26%	2,133,144	2.63%	2,025	0.0025%	日本農經大學博士	佳鼎科技董事長 邦茂投資董事 利碟公司董事 普羅米數位科技董事長 蓬萊島數位科技董事長 邦英英生物科技董事長 聯茂投資董事長 佳通投資董事長	—	—	—
董事	和通創業投資(股)公司 代表人：陳欽煒	89.06.16	3年	636,381	1.41%	882,807	1.09%	—	—	美國伊利諾州大學財務碩士	和通創投董事 佳通創投董事 久尹公司董事 全天時科技董事 亞洲全通董事 進宣科技董事 勝通創業投資監察人 大通開投投資董事 利通創業投資董事 英屬維京群島商惠通投資董事 萬通創業投資董事 前通創業投資監察人	—	—	—

職稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事	樺彩(股)公司 代表人：張金仲	90.05.25	註	875,000	1.40%	980,000	1.21%	—	—	政治大學企管系 美國堪薩斯州立大學企管碩士	樺彩公司董事長 利倫企業董事長 利隆企業董事長 利倫科技董事長 利怡企業董事長 理源企業董事長 華世國際科技顧問董事長 美隆電器廠監察人	—	—	—
董事	馬君梅	91.10.22	註	—	—	—	—	—	—	美國北卡羅萊納會計碩士	東吳大學商學院院長 東吳大學會計系主任	—	—	—
董事	白蓉生	91.10.22	註	—	—	—	—	—	—	中央大學化學系	電路板協會技術顧問 電路板資訊雜誌社長	—	—	—
監察人	洪振攀	90.05.25	註	168,437	0.27%	566,358	0.70%	2,867	—	台大化工所碩士	擎邦國際科技董事長 藍科數位科技董事長 邦拓生物科技董事 彬台科技董事	—	—	—
監察人	寶聚投資(股)公司	91.10.22	註	—	—	1,500,000	1.85%	—	—	--	--	—	—	—
監察人	宋同慶	91.10.22	註	—	—	—	—	—	—	政大企研所	台灣本乙烯工業副總 中央投資公司投資部經理			

註：任期至本屆董事及監察人任期屆滿止。



2. 法人股東之主要股東：

92年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
寰邦投資股份有限公司	陳俞安、林吳靜都、林正弘、林儀婷
和通創業投資股份有限公司	百慕達商和通投資控股公司、交通銀行
樺彩股份有限公司	張金仲、張家源、張家彰、謝明君
寶聚投資(股)公司	盧攀聚、簡麗珠、盧明燦、盧明德、盧宗焜

3. 董事或監察人具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗及條件

姓名	條件 具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗	非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人	非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之十以上或持股前十名之自然人股東	非為前二類之配偶或其二親等以內直系親屬	非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人	非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東	非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶	備註
董事長／萬海威	✓			✓	✓	✓	✓	-
董事／高繼祖	✓			✓	✓	✓	✓	-
董事／黃琇卿	✓	✓		✓			✓	-
董事／徐超俊	✓			✓	✓		✓	-
董事／寰邦投資(股)公司代表人林邦充	✓			✓			✓	
董事／和通創業投資(股)公司代表人陳欽煒	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
董事／樺彩(股)公司代表人張金仲	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
董事／馬君梅	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事／白蓉生	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
監察人／洪振攀	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
監察人／寶聚投資(股)公司				✓				-
監察人／宋同慶	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

註：各董事、監察人符合上述各條件者，於各條件下方空格中打“✓”。

### 三、資本及股份

#### (一) 股本形成經過

##### 1. 最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動情形

單位:股;元

年月	發行價格 (元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者	其他
86.04	10	50,000,000	500,000,000	22,000,000	220,000,000	設立資本	無	-
86.08	15	50,000,000	500,000,000	32,000,000	320,000,000	現金增資 10,000,000 股	無	-
88.04	15	50,000,000	500,000,000	45,000,000	450,000,000	現金增資 13,000,000 股	無	-
90.03	現金增資 15 元;盈餘及公 積轉增資 10 元	70,000,000	700,000,000	62,450,000	624,500,000	現金增資 10,000,000 股 盈餘及公積轉增資 7,450,000 股	無	-
90.09	10	74,000,000	740,000,000	71,144,000	711,440,000	盈餘及公積 8,694,000 股	無	-
91.03	10	100,000,000	1,000,000,000	81,144,000	811,440,000	現金增資 10,000,000 股	無	-

2. 最近年度及截至公開說明書刊印日止私募普通股之執行情形：無。

#### (二) 最近股權分散情形

##### 1. 主要股東名單

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東名稱、持股數額及比例

92年4月14日

主要股東名稱	股 份 持 有 股 數	持股比例(%)
佳鼎科技(股)公司	5,333,410	6.57
開發國際投資(股)公司	3,102,400	3.82
徐超俊	2,814,523	3.47
泰隆開發(股)公司	2,222,000	2.74
寰邦投資(股)公司	2,133,144	2.63
簡麗珠	2,013,725	2.48
萬海威	1,635,820	2.02
鴻源科技(股)公司	1,514,000	1.87
寶聚投資(股)公司	1,500,000	1.85
盧宗焜	1,479,000	1.82
合 計	23,748,022	29.27

2. 最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十股東放棄現金增資認股之情形

(1) 董事、監察人及大股東放棄現金增資認股情形

單位：股

職 稱	姓 名	90 年度		91 年度		92 年度截至 公開說明書刊印日 止	
		可認 股數	實認 股數	可認 股數	實認 股數	可認 股數	實認 股數
董 事	萬海威	118,000	118,000	206,113	--	--	--
董 事	高繼祖	64,000	64,000	156,580	--	--	--
董 事	黃琇卿	150,000	--	116,424	--	--	--
董 事	徐超俊(註1)	409,687	409,687	354,629	--	--	--
董 事	寰邦投資(股)公司代表人：林邦允	573,562	--	268,776	--	--	--
董 事	和通創業投資(股)公司代表人：陳欽煒	127,276	--	98,786	98,786	--	--
董 事	樺彩股份有限公司代表人：張金仲 (註1)	--	--	123,480	--	--	--
董 事	馬君梅	--	--	--	--	--	--
董 事	白蓉生	--	--	--	--	--	--
監察人	洪振攀(註1)	30,625	--	47,709	47,709	--	--
監察人	寶聚投資(股)公司	--	--	1,500,000	1,500,000	--	--
監察人	宋同慶	--	--	--	--	--	--
解任董事	林正弘(註1)	154,853	--	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)
解任監察人	呂世光(註1)	40,000	--	(註2)	(註2)	(註2)	(註2)

註1：董事林正弘90.2.19解任。另90.05.25增加董事樺彩(股)公司及監察人呂世光，監察人徐超俊轉任董事，董事洪振攀轉任監察人。

註2：解任後之資料不予揭露。

(2) 所放棄之現金增資股洽關係人認購明細

單位：股；元

日期	認購人姓名	與公司、董事、監察人、 持股比例百分之十以上股東之關係	認購股數	價格
90 年度	李梅	本公司董事兼總經理之配偶	200,000	15
90 年度	高邵玉琴	本公司董事長之二親等	100,000	15
91 年度	李梅	本公司董事兼總經理之配偶	350,000	10
91 年度	黃琇絹	本公司董事之二親等	454,642	10
91 年度	孫心皓	本公司董事長之配偶	242,946	10
91 年度	孫希聖	本公司董事長之二親等	14,859	10

(三) 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：仟股，新台幣元

項 目	年 度		90年	91年	92年 第一季止
	每股市價	最 高		未上市櫃	13.95
最 低			未上市櫃	13.00	11.15
平 均			未上市櫃	13.47	11.84
每股淨值	分配前		11.11	11.95	12.02
	分配後		11.03	--	--
每股盈餘	加權平均股數		68,644,000股	79,445,000股	80,789,000股
	每股盈餘(註 2)	調整前	0.50	1.03	0.36
		調整後	0.50	1.03	0.28
每股股利(註1)	現金股利		--	0.20	--
	無償配股	盈餘配股	1.00	0.30	--
		資本公積配股	0.20	--	--
	累計未付股利(註3)		--	--	--
投資報酬分析	本益比(註4)		--	13.08	--
	本利比(註5)		--	67.35	--
	現金股利殖利率(註6)		--	1.48%	--

註 1：91年度乃預計配發之股利，尚未經92年股東會通過，實際股利發放金額以股東會通過為準。

註 2：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

註 3：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，揭露截至當年度止累積未付之股利。

註 4：本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。

註 5：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註 6：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

四、員工分紅及董事、監察人報酬

(一) 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度結算如有盈餘，應依法提繳稅款、彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積，如尚有盈餘，分配如下：

1. 員工紅利百分之八。惟每年員工分紅辦法須由總經理擬定提報董事會核定後發行之。
2. 董事及監察人酬勞百分之二。
3. 餘額應由董事會擬具股東紅利分派議案提請股東會決議分配之。

(二) 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

1. 本公司九十一年度盈餘分配議案於92年3月25日業經董事會通過，有關董事會通過擬議分派情形如下：
  - (1) 配發員工現金紅利：5,881,897 元；
  - (2) 董事、監察人酬勞：1,470,474 元；
  - (3) 股東紅利-股票：24,343,200 元；
  - (4) 股東紅利-現金：16,228,800 元。
2. 配發員工股票紅利股數及其佔盈餘轉增資之比例：無
3. 配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：0.94 元。

(三)上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞之情形：

本公司上年度(九十年度)盈餘實際配發員工紅利及董監酬勞之有關資訊如下：

	九十年度		
	股東會通過實際配發情形	董事會通過擬配發情形	差異
員工紅利	4,336,016	4,336,016	無
董事、監察人酬勞	1,084,004	1,084,004	無

## 貳、營運概況

### 一、公司之經營

#### (一)業務內容

##### 1. 業務範圍

##### (1) 主要業務內容

←多層印刷電路基板及銅箔基板及其半成品、成品之製造、加工與買賣。

↑前項產品製造設備之進出口貿易。

##### (2) 目前之商品(服務)項目及營業比重

單位：新台幣仟元

產品項目	91年度	
	金額	營業比重(%)
玻璃纖維膠片	325,871	19.02
銅箔基板	685,820	40.03
多層壓合基板	698,222	40.75
其他	3,374	0.20
合計	1,713,287	100.00

##### (3)計畫開發之新商品(服務)項目

- ①適合高頻通訊用之低介質常數(Low Dk)基板。
- ②因應環保要求之非鹵素(Halogen-Free)基板。
- ③可提升產能25%之快速硬化(Fast Cure)膠片。
- ④軟硬板(Rigid-Flex)壓合低流動性(No Flow)膠片。
- ⑤阻抗±5%多層板之開發。
- ⑥0.2mm薄多層板之開發。
- ⑦增層法(Build up) Mass Lam之研發。
- ⑧盲孔 Mass Lam量產製程研發
- ⑨內層3mil/3mil之研發

### 2. 產業概況

#### (1) 產業現況

玻璃纖維膠片、銅箔基板及多層壓合基板均係供製作印刷電路板(Printer Circuit Board or Printed Writing Boards；簡稱 PCB or PWB)之用，是以其行業景氣動向與印刷電路板業之榮枯息息相關。印刷電路板內部構造主要是由內層的銅箔基板及外層的銅箔所

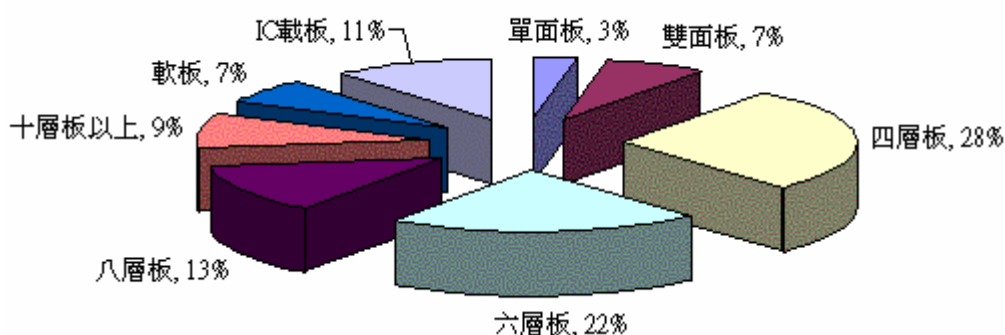
構成，銅箔基板除需具備印刷電路板製作時所需之機械加工強度及電器絕緣性能外，依不同功能印刷電路板之要求，另需具備良好之熱傳導性、抗化學藥品性、耐高溫或其他特殊性能要求；而玻璃纖維膠片則是作為銅箔基板與銅箔間的絕緣材；另多層壓合基板係印刷電路板前段製程，包括內層電路製作及壓合成型，為印刷電路板之半成品。以下謹就印刷電路板產業及銅箔基板產業說明之：

#### ←印刷電路板產業

印刷電路板係提供電子零組件在安裝與互連時的主要支撐體，為所有電子產品不可或缺的主要基礎零件，舉凡資訊與通訊產品、工業及醫療器材、軍事、航太用品及消費性電子產品等皆須使用到印刷電路板做為各種主/被動元件之載體。2001年因全球經濟景氣不振，網路、資訊、消費性電子及通訊等相關產品之需求均呈現萎縮態勢，位居上游之印刷電路板在庫存量待消化且需求又不明朗下，亦陷入衰退的陰霾中，根據美國電路板協會(IPC)統計，2001年全球PCB產值衰退21.5%，其中以美國地區衰退35%最為嚴重，日本則因行動電話及電腦等通訊及資訊產品需求驟降，印刷電路板產值亦較2000年減少24%，而台灣及南韓亦難擺脫產業負成長之情形。至於中國大陸則受惠於內需市場持續熱絡，電子產品需求量不斷上升，加上生產成本相對低廉，政府當局招商積極，遂吸引國內外廠商持續湧進，促使其PCB產業規模逐步擴大，故為全球唯一不受景氣影響且仍呈成長之地區，根據美國印刷電路板IPC資料顯示，2001年大陸地區印刷電路板之產值佔全球比重已由2000年之8.7%竄升至13.7%，並超越台灣成為全球第三大印刷電路板生產地，成長力道十分強勁，由於大陸經濟正處高成長階段，資訊及通訊產品銷售額不斷向上推升，印刷電路板之需求亦隨之水漲船高，故大陸市場已為全球PCB廠商兵家必爭之地。

我國印刷電路板產業起源於桃園，目前約有85%之專業廠商叢集在台北、桃園、中壢、新竹等方圓70公里之區域，而上、下游相關週邊支援廠商及各類供應商數百家亦皆群集於此一區域，致整個產業結構發展相當完整，同時在產品品質、價格與交期上亦擁有相當之優勢，促使國際知名電腦大廠紛紛來台下單。若以產品組合區分，依TPCA資料顯示(圖一)，2001年我國生產之軟板佔7%、單面板佔3%、雙面板佔7%、IC封裝載板佔11%、四層板以上之多層板佔72%，是以多層印刷電路板係我國印刷電路板之主力生產產品，而未來隨科技進步，各項電子產品不斷朝多功能、體積小的方向發展，多層板所佔比重仍將逐年提高。另根據工研院經資中心ITIS計畫統計資料顯示，2002年在資訊、網路通訊及遊戲機等訂單挹注下，我國印刷電路板之產值將較2001年成長8.5%，大於全球產值5.3%之成長率，因此2002年我國印刷電路板之全球市佔率將由2001年之11.46%小幅提升至11.81%。

圖一：2001年電路板國內整體銷售產品分佈圖



資料來源：TPCA 及工研院經資中心 ITIS 計劃，2002 年 7 月

表一：我國印電路板產值於全球之市佔率

		單位：%				
	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年(e)	
我國市佔率	8.72	8.86	11.14	11.46	11.81	

資料來源：台灣經濟研究院，2002 年 11 月

PCB 廠商在歷經兩年之慘澹經營，歐、美 PCB 大廠如 Flextronics 及 Sanmina-SCI 相繼被迫祭出裁員甚或關廠措施，據統計 2000 年底至 2002 年 10 月美國各大印刷電路板關閉 64 個工廠，產能減少 22%，而日本廠商也因經營成本過高，釋出龐大訂單至生產成本較具競爭力的大陸及台灣等地，雖然歐美大廠裁員甚或關廠不利消息傳出，卻也有助紓緩 PCB 供過於求情形。展望 2003 年，由於全球通信系統業者積極推動 GRPS 及 3G 服務，手機應用不斷推陳出新，在新功能如數位相機、彩色螢幕等新功能導入下，可望刺激一波換機需求，據 Dataquest 預估，2003 年手機需求量及手機出貨量成長率將分別達 5.8% 及 6.4%，此將帶給國內手機板 PCB 廠商不少商機；至於資訊用板方面，在歷經 1998、1999 年企業採購電腦熱潮後，大多數電腦較現今機種規格有一段落差，2003 年企業市場換機需求可望湧現，並對資訊板需求產生推波助瀾效果；另就光電板言，近年來國內平面顯示器產業快速興起，成長力道強勁，而在台灣業者重金投資的五代 TFT LCD 產能將於 2003 年陸續開出下，光電板將有其發揮空間。

依 NT Information 對全球 PCB 產業展望分析顯示（參表二），2003 年 PCB 產業將揮別過去連續兩年負成長格局，預計將成長 7.23%，其中成長力道最為強勁的係來自於亞洲地區的台灣、大陸與韓國，而 2001~2005 年之全球 PCB 產業年複合成長率將達 5.8%。此外，依據美國 PCB 專業研究機構 IPC(Institute for Printed Circuits) 資料(參表三)，2002 年以來北美 PCB 產業的 B/B 值多在代表供需趨於平衡的 1 上下盤旋，亦顯示在業界控制產出下，產業產值再下跌機率不大，故 PCB 產業復甦可期，而台灣 PCB 廠挾其既有的經營優勢，配合下游電子產業之景氣回溫，以及歐、美、日大廠基於成本考量，有加速向海外釋出代工訂單之趨勢下，國內 PCB 業者將仍具相當之發展空間。

表二：全球 PCB 產值

		單位：百萬美元					
年度 地區	2000	2001	2002(e)	2003(f)	2004(f)	2005(f)	2001~2005 複合成長率
美國	11,400	8,300	6,700	6,300	6,500	6,600	(1.60%)
歐洲	5,200	4,700	4,400	4,200	4,300	4,400	(5.60%)
日本	11,900	8,600	8,700	9,300	9,800	10,200	4.40%
亞洲	12,400	11,200	12,000	14,300	16,800	19,800	15.30%
合計	40,900	32,800	31,800	34,100	37,400	41,000	5.80%
成長率	14.70%	(19.80%)	(3.05%)	7.23%	9.68%	9.35%	—

註：上述統計值尚不包括其他地區

資料來源：N.T Information 2002/10

表三：2002 年北美 PCB 產業之訂單/出貨比值



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
B/B值	1.01	1.0	0.98	0.94	0.96	0.96	0.99	0.98	0.95	0.91	0.92	0.96

資料來源：IPC

## ↑銅箔基板產業

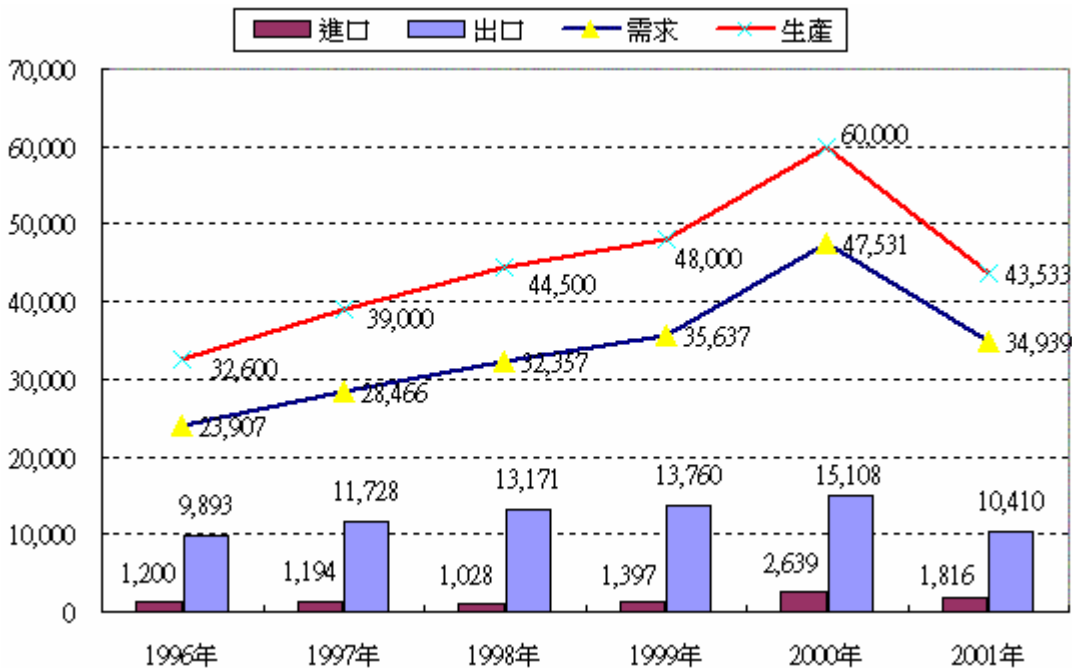
銅箔基板係由玻璃纖維膠片及銅箔壓合而成，為製造印刷電路板之關鍵基礎材料。玻璃纖維膠片係以預浸纖維紙或玻璃纖維布等補強材料作基材，浸以酚醛樹脂或環氧樹脂膠黏劑，經乾燥、裁剪、疊合成坯料，再於其單面或雙面覆上銅箔，在加熱加壓條件下成型為銅箔基板，其中銅箔作為電子零件間的線路連接導體，而玻璃纖維膠片則作為電子零件間的絕緣體或供作支架用。

我國銅箔基板起源於 60 年代，由大同公司自日本東芝引進紙質單面板的技術開始，隨後於 1982 年由日本三井與國內台陽公司合作生產電解銅箔，緊接著長春石化及南亞塑膠研發完成加入生產，而後橡樹電子首開生產 FR(玻纖樹脂基板)類之板材，是以我國銅箔基板發展迄今已逾 30 年。

銅箔基板種類眾多，依其使用材料及應用基板層數大致可分為紙質酚醛樹脂單面基板、複合環氧樹脂基板(CEM-1)、玻璃纖維環氧樹脂基板(FR-4)、高性能樹脂板及軟質性基板(FCCL)等五種，近年來隨著電子產品的多功能化、小型化發展，電路板上需負載更多的功能，單面電路板已不敷需求，多層電路板因應而起，由於玻璃纖維環氧樹脂基板主係供多層板及球腳封裝載板(BGA)使用，因此印刷電路板業者對玻璃纖維環氧樹脂基板的需求持續增加。

根據台灣電路板協會(TPCA)及工研院經資中心統計(圖二)，2001 年國內銅箔基板之總產值為 435.33 億元，出口值與進口值為 104.14 億元與 18.16 億元，分別較 2000 年下滑 31.4% 及 31.2%，而 2002 年因新穎電子產品如數位相機、X-BOX、TFT-LCD、彩色手機等陸續推陳出新之推波助瀾下，總產值將為 474.8 億元，預估較 2001 年成長 9.07%。

圖二：台灣銅箔基板歷年進出口統計圖



資料來源：中華民國海關進出口統計資料、工研院經資中心ITIS計劃及TPCA；2002年10月

## (2) 發展趨勢

### ←印刷電路板

近年來由於電子科技業購併及策略合作之風氣盛行，促使國內印刷電路板業者亦興起購併整合之風潮，不論是透過同業間之合作，整合上下游資源，以達到生產成本之降低，或異業間之策略聯盟，以擴大營運利基等，均不斷發生，致市場集中化程度愈來愈高，在大廠具備各項優勢下，未來印刷電路板廠商大者恆大之趨勢將愈加明顯。

另由於印刷電路板產品目前處於產業生命週期之成熟期，未來除價格競爭仍持續外，在資訊、通訊、IA等電子產品朝向輕薄短小、可攜式、高功能化、高密度化、高可靠性及低成本的趨勢下，新一代封裝技術將不斷出現，故如何提升印刷電路板之設計組裝密度，將是各廠商於電路板技術上最具挑戰之議題。此外，在多層印刷電路板的線寬/線距，目前國內主流產品仍以5mil/5mil佔大多數，惟已有3mil/3mil的量產能力；在孔徑方面，機械鑽孔的孔徑已可達9.8mil；而層數6~8層已成主流(參表四)。故在產品功能快速演進，市場競爭激烈之下，如何以簡易且低成本的製程技術，實現高密度化、孔徑細微化，將是印刷電路板業者在產品差異化策略上的競爭利器。

表四：我國印刷電路板廠商技術能力現況

區分		目前具備最高的量產技術能力	目前最常用的量產技術層次
線寬/間距	內層	3mil/3mil	5mil/5mil
	外層	3mil/3mil	5mil/5mil
電鍍前之最小孔徑	雷射鑽孔	4mil	5~9mil
	機械鑽孔	9.8mil	13~16mil
縱橫比		6:1	4:1
SMD墊寬/墊距		8~10mil/8~10mil	11~20mil/11~20mil
多層板之層數	單次壓合	14層	6~8層
	逐次壓合	6~8層	6~8層
大排版能力		20吋×24吋	18吋×24吋
綠漆對位精準度		<2mil	<3~4mil
層間對位精準度		<3mil	<3~4mil

資料來源：本公司及產業經濟第245期，2002年1月

而在電子產品朝向功能多樣與體積輕小同時具備之趨勢下，佈線密度與印刷電路板層數已成為難以兼顧的課題，惟新一代高密度連接基板(High density interconnection；HDI)結構所使用之增層法(Build up)製程，係以突破傳統機械式鑽孔之技術限制，採用雷射鑽孔及外層曝光等方式形成0.2mm以下之盲/埋孔或穿孔之技術，可減少通孔於板上所佔之面積，使得佈線密度較高，因而得以解決此一難題。由於HDI板佈線密度高，在訊號反應速度上較快，高階產品舉凡PDA、手機、Rambus相關產品、IC封裝基板、航太及未來的IA產品等，均為HDI板典型的應用產品，應用比重則屬通訊產品最高(參表五)。近年來消費性電子產品、精密機械、醫學用及通訊用板等，使用HDI板的比重已有越來越高之趨勢，HDI的運用範圍亦將更為普及，加之歐美手機大廠如Nokia、Ericsson、Motorola等，均已陸續將手機結構逐步移轉至HDI板生產，故為爭取手機板之訂單，國內印刷電路板業者亦逐漸轉至HDI技術，料將快速帶動國內印刷電路板產業朝此領域發展。

表五：全球 HDI 微孔電路板類之產值成長

單位：百萬美元

產品/年度	1998年	1999年	2004年	比重(註)
PC	128	165	411	8.0%
通訊	252	545	3,147	61.5%
數位顯像	147	195	495	9.7%
汽車用板	10	12	126	2.5%
高階系統產品	34	45	550	10.8%
醫療、控制與軍事	9	11	98	1.9%
其他	87	95	290	5.7%
合計	667	1,068	5,117	100%

註：比重係以2004年之數據為準。

資料來源：Prismark

### ↑銅箔基板

近年來隨著電子產品發展趨勢，銅箔基板整體之材料選用、尺寸安定性、重量、設計方式、加工性均需改變，以配合環保訴求，並因應高頻高速產品、輕薄短小之趨勢及易加工性等方面的需求。另為降低資料在傳輸過程中遺漏或干擾，銅箔基板材料已朝向低介質化、低膨脹量、薄型多層化、高耐熱化方向發展，以符合未來無線通訊網路電子產品高信賴度與多功能化之需求。

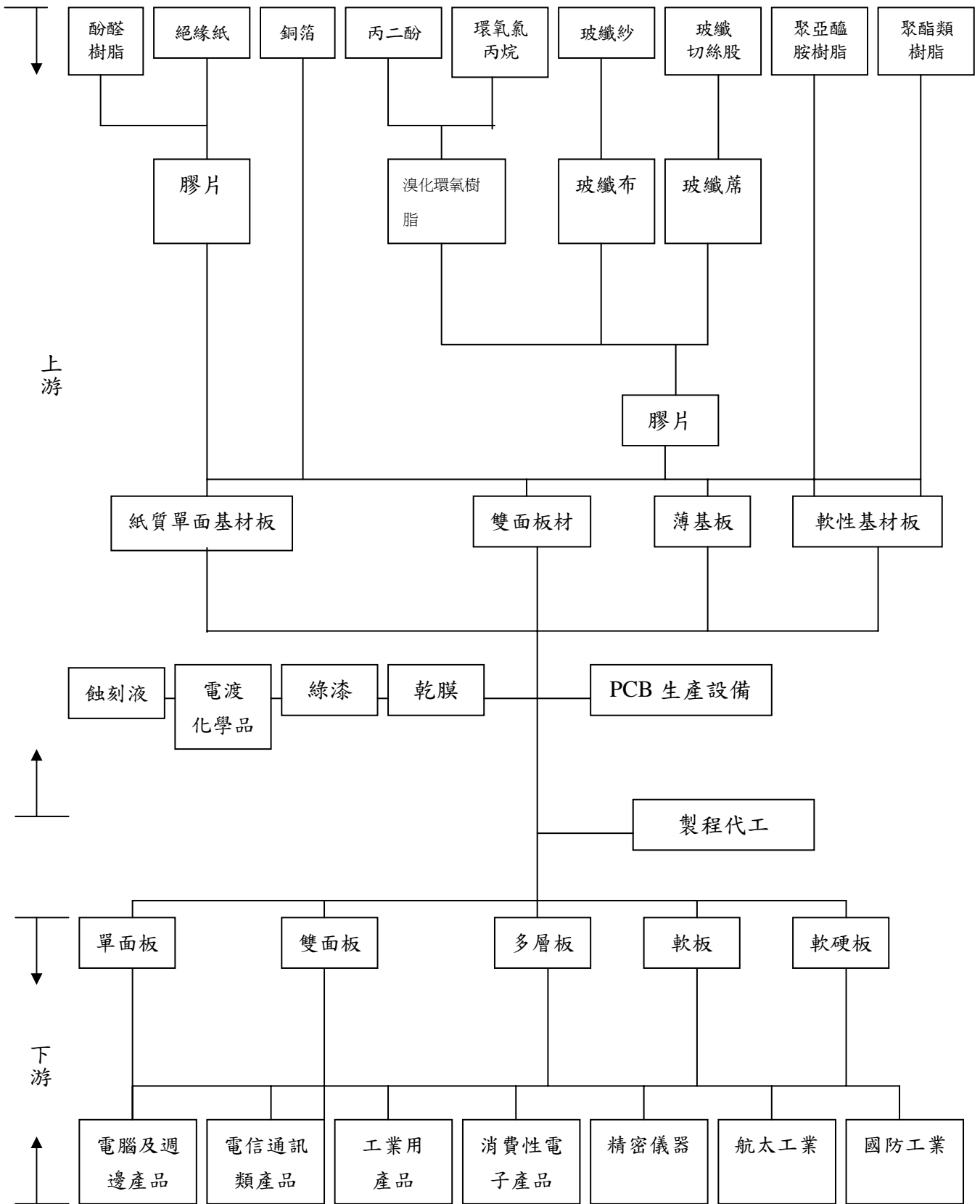
此外，以傳統銅箔覆蓋及蝕刻技術很難製作成微細導線，而創新之增層板或高密度連接基板正可符合其要求，並可使電路板面積較以往縮小，及縮短產品線路之設計時間。再者，隨著印刷電路板朝向高功能及多層板發展，致多層板之薄基板需求逐漸增加，故適時擴充高層次銅箔基板產能，將為該產業提昇未來競爭力之重要關鍵。

### (3) 產業上、中、下游之關聯性

在所有印刷電路板廠商中，本公司的業務型態比較特殊，本公司主要產品係為玻璃纖維膠片、銅箔基板及多層壓合基板，其中銅箔基板及玻纖膠片是屬於印刷電路板的上游材料，而多層壓合基板則是印刷電路板製程中的前段製程，因此本公司係整合了上游原料的前段製程(內層製程)廠商。

銅箔、樹脂、玻纖布是印刷電路板產品最上游的原料，藉由這些原料可生產出銅箔基板及玻璃纖維膠片，而印刷電路板就是由銅箔、銅箔基板及玻璃纖維膠片所生產出來的。我國之印刷電路板產業體系相當完備，從銅箔、樹脂、玻纖布到印刷電路板皆有廠商生產，自給度相當高。本公司所生產之銅箔基板及玻璃纖維膠片除一部份自己用來生產多層壓合基板外，其餘則銷售給一般印刷電路板廠商使用。印刷電路板上下游產業涵蓋範圍甚廣，茲將其產業關聯圖列示如下：

圖三：印刷電路板產業結構體系



資料來源：整理自工研院材料所 ITIS 計劃

#### (4) 產品發展趨勢及競爭情形

##### ㄨ玻璃纖維膠片、銅箔基板

電子產品走向輕薄短小之趨勢，以傳統銅箔覆蓋及蝕刻技術很難製作成微細導線，故創新之增層板或高密度互連板，將可使電路板面積較以往縮小，並可縮短產品線路之設計時間。另隨著多層印刷電路板朝向高功能及高多層板發展，致高多層板之薄基板需求逐漸增加。

銅箔基板業者未來發展將積極開發背膠銅箔基板(Resin Coated Copper, RCC)，主要是高密度連結基板多採用雷射鑽孔機鑽孔，但受到玻纖環氧基板中之玻璃纖維布影響，導致雷射鑽孔時出現偏差，若改採無玻璃纖維布的背膠銅箔基板即可克服此問題(因使用背膠銅箔基板之印刷電路板厚度祇有使用玻纖環氧基板之印刷電路板的1/2)。惟現階段背膠銅箔基板價格高於玻纖環氧基板，未來若能克服此問題，則一定有其發展空間。

本公司目前所生產之銅箔基板係屬於玻璃纖環氧樹脂基板(FR-4)，而市場上約有十六家製造商生產此類產品供下游印刷電路板使用，目前上市公司中有生產者為南亞、宏泰電工及台光電子，上櫃公司則為合正科技及華韜電子，惟南亞及宏泰電工均尚有生產其他產品，基板僅為其營業產品之一，另未上市公司中德聯、寶利德及松下電工則為外商投資成立之專業基板製造商，而松下電工所銷售之基板多數均供華通電腦公司所使用。

##### ㄣ多層壓合基板

近年來在低價電腦的風潮下，使得國際資訊大廠為降低製造成本而選擇代工能力強、機動性高的台灣廠商作為其合作之對象。另近年來全球電子資訊產業之快速變遷，在資訊、通訊、光電及消費性電子產品需求增加下，勢必帶動高層數印刷電路板產品之成長，而對前段製程—多層壓合基板之產能需求亦增加。

目前國內從事由內層一貫作業至壓合之生產廠商僅有三家，依規模由大至小分別為合正、本公司及聯致。

### 3. 技術及研發概況

#### (1) 技術層次及研究發展

##### ←技術層次

項目		未來具備最高的量技術能力	目前具備最高的量技術能力
板厚	內層最薄(mm)	0.1	0.2
	內層最厚(mm)	3.2	2.4
銅厚	內層最薄(oz)	1/4	1/3
	內層最厚(oz)	6	5
內層線寬/線距		3/3	4/4
層間對準度	四層(mil)	<1.5	<2
	多層(mil)	<3	<4
阻抗控制		±5%	±8%
量產最高層板		20	14
Tg		130°C~250°C	130°C~180°C
高密度 PCB Mass Lam		增層法代工	盲埋孔板代工

##### ↑研發概況

本公司於 86 年成立時，即設立研發部門，主要致力於銅箔基板新產品之開發、新

原物料評估及生產製程技術改善。在工程部門主要負責多層壓合基板新製程、新設備研發及銅箔基板新產品之 PCB 加工性、可靠性之評估。使其兩部門功能相輔相成，以加速新產品開發時程並提供客戶完整技術資料及服務。

本公司關鍵研發人員均具有 5 年以上銅箔基板及 PCB 專業技術經驗，研發團隊具備堅實之技術能力。本公司極重視人材培育常派員參加各種專業訓練課程及國際性電路板展覽及論壇，使研發人員具備獨立研究開發與分析能力。此外，藉由通過經濟部主導性專案計畫及業界科專計畫，本公司研發部門奠立良好研發管理制度。從產品組成分析、配方研製、製程、放大技術、材料特性評估方法／標準建立及新產品 PCB 加工性評估，已建立一套完整新產品開發流程。對於新產品開發牽涉的技術層次既高又廣，產品的時效性較為迫切，除自行開發大部份的關鍵技術外，並與國內研究機構合作計劃之方式，以期縮短開發時程。並迅速建立相關的關鍵技術，大幅提升技術能力及自創研發能力。

## (2) 研究發展人員與其學經歷

職稱	姓名	學歷	經 歷
經理	周文賢	中央大學化工碩士	亞洲化學(股)公司研發組長
副工程師	陳麗芬	南亞工專	天揚精密化學員
副工程師	蔡玉蓮	南台工專化工科	亞洲化學(股)公司助理研究員
工程師	蔡秉漳	淡江大學化工碩士	建台藥廠化驗師
助理工程師	連國嵐	中原大學化工系肄業	永新製藥品管
工程師	黃成義	永平高職機械科	聯茂電子上膠課課長
工程師	陳柏宏	中央大學化工碩工	南亞科技工程師
資深主任工程師	葉土生	清華大學高分子碩士	亞洲化學高級研究員
工程師	黃俊達	中興大學化學碩士	雙邦化學研究員
主任工程師	邱振雄	交通大學應用化學碩士	聯茂，亞化研究員
課長	黃朝昌	中原大學工業工程系	聯茂工程師
副工程師	王郁勛	高雄科技學院化學工程系	耀文電子製程工程師

## (3) 最近五年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品

單位：新台幣仟元

年 度	87 年度	88 年度	89 年度
金 額	14,150	14,563	12,148
開發成功之技術或產品	1. 開發及改進四官能基樹脂成份之膠片與基板在生產製造方面之技術 2. 開發及改善 Tg140°C (FR-4) 薄基板之尺寸安定性 3. 開發完成 Tg150°C，膠片及基板量產化技術	1. 開發完成 Tg180°C，膠片及基板量產化技術 2. 藉由經濟部主導性專案計畫，順利完成新型硬化劑合成技術及美，日專利申請	1. 開發完成低介質常數 (DK=3.6-3.9) 之膠片及基板量產化技術 2. 藉由經濟部業界科計畫，完成新型促進劑合成技術和中華民國專利申請

年 度	90年度	91年度
金 額	25,195	42,088
開發成功之技術或產品	1. 開發完成非鹵素(Halogen-free)膠片及基板 基板 Pilot-Run 開發 2. 開發完成雷射鑽孔用之膠片量產化技術 3. 開發完成 Anti-CAF 用之膠片及基板量產化技術 4. 通過“第三代通訊基板用膠片開發”主導性專案計畫	1. 開發完成耐候性抗離子遷移(Anti-CAF)材料 2. 開發完成IC封裝載板材料(IT 180 FC) 3. 多層板內層線寬、線距達3mil/3mil，層數由12層板提升至16層板

## (二)市場及產銷概況

### 1. 市場分析

#### (1)公司主要商品之銷售地區

本公司之主要產品為玻璃纖維膠片、銅箔基板及多層壓合基板，主要銷售對象為印刷電路板製造廠商，銷售地區除台灣外，尚涵蓋亞洲、美洲及歐洲等地，最近三年度外銷比例平均約佔61.78%。本公司主要銷售產品之種類及內外銷比例列表如下：

單位：新台幣仟元

項目	年度	89 年度		90 年度		91 年度	
		銷售金額	佔營收比例%	銷售金額	佔營收比例%	銷售金額	佔營收比例%
玻璃纖維膠片	內銷	163,911	13.24	155,123	11.52	143,775	8.39
	外銷	99,775	8.06	193,510	14.37	182,096	10.63
	小計	263,686	21.30	348,633	25.89	325,871	19.02
銅箔基板	內銷	92,391	7.46	180,567	13.41	219,074	12.79
	外銷	176,743	14.28	306,784	22.78	466,745	27.24
	小計	269,134	21.74	487,351	36.19	685,820	40.03
多層壓合基板	內銷	124,158	10.03	200,367	14.88	383,420	22.38
	外銷	577,932	46.69	308,571	22.92	314,802	18.37
	小計	702,090	56.72	508,938	37.80	698,222	40.75
其他	內銷	2,691	0.22	662	0.05	71	0.00
	外銷	211	0.02	989	0.07	3,304	0.19
	小計	2,902	0.23	1,651	0.12	3,375	0.20
合計	內銷	383,151	30.95	536,719	39.86	746,340	43.56
	外銷	854,661	69.05	809,854	60.14	966,946	56.44
	小計	1,237,812	100.00	1,346,573	100.00	1,713,287	100.00

#### (2)市場佔有率

本公司自始即對品質要求嚴格，持續投入研發，致力於高性能基板之生產，並提供全方

位之售後服務，由於品質穩定，產品受市場認同，雖在同業競爭壓力下，其成功的行銷策略及產能之充分利用，致其營收淨額及獲利均呈穩定成長，且為擴大營收並因應市場需求陸續擴建生產線，以增加產能，未來在持續致力新產品的研發及國內外市場的拓展、資訊業的普及下，本公司之市場遠景應屬可期。

國內目前約有十六家生產FR-4銅箔基板主要廠商，因其大多為未上市櫃公司，並無公開統計資料可計算其市場約有率，惟依據本公司及其同業自行推估之營收資料統計如下表，本公司90年度營收之市場約略佔有率為4.8%，且本公司90年度營收為唯一正成長之廠商，顯示本公司具良好之競爭力。

單位：百萬元

90年營收排名	公司名稱	89年營收	90年營收	營收成長率(%)	90年營收佔有率(%)
1	南亞	18,774	10,790	-42.5	38.4
2	德聯	3,793	2,300	-39.4	8.2
3	台耀	2,493	2,179	-12.6	7.8
4	松電工	3,782	2,077	-45.1	7.4
5	合正	2,454	1,941	-20.9	6.9
6	台光	2,060	1,514	-26.5	5.4
7	華韜	1,920	1,410	-26.6	5.0
8	慶光	2,231	1,358	-39.1	4.9
9	聯茂	1,239	1,346	8.6	4.8
10	聯達	1,367	1,196	-12.5	4.2
11	寶利得	1,620	968	-40.2	3.4
12	尚茂	842	561	-33.4	2.0
13	宏泰	916	445	-51.4	1.6
14	聯致	N. A	N. A	N. A	N. A
15	橡榮	N. A	N. A	N. A	N. A
16	旭象	N. A	N. A	N. A	N. A
	合計	43,491	28,085	-35.4	N. A

資料來源：本公司整理

### (3)市場未來供需狀況與成長性

#### ①市場未來之供需狀況：

##### A. 印刷電路板

根據N. T. Information資料顯示，2001年美國、歐洲、日本及亞洲地區PCB產值佔全球比重分別為25.30%、14.33%、26.22%及34.15%，但歐美地區及日本因環保因素及成本考量，逐步將產能釋放至日本以外之亞洲地區，至2005年亞洲地區PCB產值佔全球比重增加至48.29%；另2001~2005年全球PCB產值年複合成長率為5.80%，以亞洲地區年複合成長率15.30%為全球成長幅度最大地區，若以單一國家而言，則以大陸為全球成長幅度最大地區，台灣成長幅度雖較中國低，但以台灣廠商優異的生產管理能力，前往中國大陸設廠，持續成本優勢，因此我國印刷電路板產業成長空間相對寬廣。



表六：全球主要地區印刷電路板產值預估

單位：百萬美元

地區 \ 年度	2001	2001 各地區比重(%)	2005(f)	2005 各地區比重(%)	2001~2005CAGR(%)
美國地區	8,300	25.30	6,600	16.10	(1.60)
歐洲地區	4,700	14.33	4,400	10.73	(5.60)
日本	8,600	26.22	10,200	24.88	4.40
亞洲地區(日本除外)	11,200	34.15	19,800	48.29	15.30
總數	32,800	100.00	41,000	100.00	5.80

註：上述統計值尚不包括其他地區

資料來源：N.T Information 2002/10

### B. 銅箔基板產業

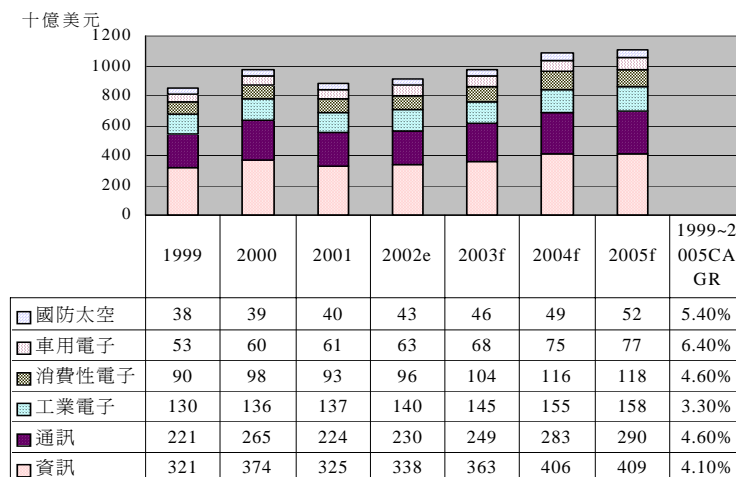
根據台灣電路板協會(TPCA)及工研院經資中心統計，2001年國內銅箔基板之總產值為435.33億元，出口值與進口值為104.14億元與18.16億元，分別較2000年下滑31.4%及31.2%，而2002年因新穎電子產品如數位相機、X-BOX、TFT-LCD、彩色手機等陸續推陳出新之推波助瀾下，總產值將為474.8億元，預估較2001年小幅成長9.07%。

## ②市場未來之成長性：

### A. 印刷電路板業

PCB是所有通訊、資訊、消費性產品、航太甚至國防等電子工業產品，不可或缺的重要零組件材料，可謂電子系統產品之母。Dataquest 預估隨著景氣復甦及新電子科技產品如 PDA 等資訊家電、數位電子產品及網通產品持續發展，全球電子系統產品市場規模將持續成長，由 2001 年 8,800 億美元成長到 2003 年 9,750 億美元，以我國廠商擅長的資訊產品成長幅度最大，此將帶動 PCB 市場成長，根據工研院經資中心 ITIS 計畫預估全球 PCB 市場規模由 1999 年 8,530 億美元成長到 2005 年 11,040 億美元。

表七：全球電子系統產品市場規模



資料來源：IC Insights(2002年)；工研院經資中心 ITIS 計畫(2002年5月)

資訊工業從 1998 年發展達成熟期至今，雖全球市場成長趨緩，然我國目前已是國際知名大廠主要尋求代工、委託設計之主要地區，主係因我國過去對資訊產品之製造技術及品質頗獲國際肯定，成為外商前來採購資訊產品之重鎮。根據資策會 MIC 預估，至 2000 年全球資訊工業市場規模為 10,148 億美元，其中硬體產品部份為 4,059 億美元，比重為 40%。2000 年我國資訊硬體業的國內外產值達 470.19 億美元，次於美國及日本，位居全球第三位，2001 年受全球經濟不景氣及美國 911 恐怖事件影響，我國資訊硬體產值較 2000 年下滑，為 426.86 億美元，惟 MIC 預估至 2003 年我國資訊硬體產值達 456.77 億美元，我國印刷電路板之需求將伴隨資訊硬體產值之提升而持續增加。

表八：我國資訊硬體業產值統計表

單位：百萬美元

年度	2000	2001	2002(f)	2003(f)
產值	47,019	42,686	42,439	45,677
年成長率(%)	17.9	-9.2	-0.58	7.63

資料來源：資策會 MIC ITIS 計劃，2002 年 11 月

除電子系統產品及資訊產品帶動 PCB 產業需求，近年來由於全球網際網路及電信事業發展迅速，PCB 產業之產品運用範圍不斷擴增，舉凡高階電腦、網路產品、行動電話、衛星接收器、汽車電子及消費性電子產品等均與印刷電路板有關，因歐美已逐步停止高污染 PCB 生產，國際大廠也相繼來亞太地區尋求 PCB 供應商，逐漸將生產重心移到亞太地區，預期將陸續釋出通訊、汽車用板的市場，因此國內 PCB 大廠亦積極開拓網路、通信、汽車及高級消費電子之市場，如 Rambas 式 DRAM 記憶卡、IC 構裝基板、HDI 基板、CSP、COB、MCM 及龐大的手機用 PCB 市場等。整體而言，在下游應用產品快速發展，需求穩定成長，及國際大廠逐漸釋出產能，我國 PCB 產業未來前景應屬可期。

另有關於前述下游產品多需使用多層板，因此將帶動內層產能需求。多層板係指四層、六層、八層、甚至更高層數的板子，其內部構造主要是由內層的銅箔基板(銅箔基板的雙面亦是銅箔)及外層的銅箔所構成，而玻纖膠片則是作為銅箔基板與銅箔間的絕緣材例。不同層數的板子對於各個製程的產能需求亦不相同：在內層方面，從多層板之內部銅箔基板片數可看出，層數越高的板子對於內層產能的需求是呈倍數式成長；在壓合及鑽孔方面，高層板中內層互連需求增加，使得埋孔需求亦增加，部分內層銅箔基板必須先進行鑽孔及壓合，待所有內層製程都完成後再做最後的壓合，因此鑽孔及壓合需求亦隨層數增加而成長。

由於層數越高的板子對內層製程產能的需求係呈倍數式提昇(六、八層板對內層製程產能的需求分別是四層板的二、三倍)；因此相對於外層製程的產能利用率偏低，內層製程產能反而逐漸顯現出吃緊的現象。預估未來內層製程產能需求仍將成長，對於從事專業內層壓合代工廠商未來前景亦屬可期。

#### B. 銅箔基板業未來成長空間

銅箔基板的景氣與印刷電路板產業的榮枯密不可分，我國銅箔基板的產值從 1992 年以來都有不錯的成長，2000 年達 600 億新台幣，國內市場需求受到電子產品大量興

起，帶動整體銅箔基板蓬勃發展，使總需求金額達 475.31 億元台幣，較 1999 年大幅成長 33.4%。而 2001 年受到全球經濟不景氣及下游 PCB 產業景氣低迷影響，使我國銅箔基板總產值下滑 16.6%，為 500 億台幣，市場總需求金額亦下滑 12.4%，為 416.32 億台幣。由全球經濟逐漸復甦及電子工業未來發展趨勢來看，未來印刷電路板的市場環境將逐漸好轉，預計將繼續保持穩定成長趨勢，加上未來產品均朝向多層板發展，帶動銅箔基板需求成長，身為 PCB 上游之銅箔基板產業，未來之發展潛力應屬可期。

#### (4) 預計銷售數量及其依據

單位：仟平方英尺

主要產品	92 年預計之銷售量
玻璃纖維膠片	105,651
銅箔基板	42,741
多層壓合基板	6,268
其他	--

##### ←玻璃纖維膠片 (PP)

本公司持續提昇生產技術及高層次產品之研發，提高新產品(High Tg)銷售比重，並積極爭取國內大廠訂單。

本公司依據九十一年度及九十二年一至二月實際銷售量，預計九十二年度銷售量較九十一年度增加約 49%；平均價格減少約 10%；致銷售值仍較九十一年度增加約 31%。

##### ↑銅箔基板(CCL)

本公司不斷尋求品質與營運之改善，並推行全方位之售前與售後服務，持續推出低介質基板及特殊規格基板等新產品，預計亞洲地區客戶開發效益顯現，可致使產銷量值持續成長；並預計開發國內前十大 PCB 廠為新客戶，於國外建立新銷售據點，以擴大北美、歐洲及東北亞等地區銷售，經依九十一年度及九十二年一至二月實際銷售量，預計九十二年度銷售量較九十一年度增加約 70%；平均價格減少約 14%；致銷售值仍較九十一年度增加約 45%。

##### →多層印刷電路板基材(Mass Lam)

本公司預計九十二年內層代工將逐季成長，加上國內外開發客戶業務成長；另本公司銷售多層印刷—電路板基材的銷售組合於九十二年將由九十一年之四層板改為以六層板及以上高階產品為銷售重心，經依九十一年度及九十二年一至二月實際銷售量，預計九十二年度銷售量較九十一年度增加約 34%；平均價格增加約 5%；致銷售值仍較九十一年度增加約 38%。

#### (5) 競爭利基

##### ① 市場利基

- 產品定位明確，鎖定高附加價值之薄板、高級材料及特殊規格等利基市場。
- 不斷開拓新客戶，目前前十大銷售客戶大多為全球前五大印刷電路板廠商，由於銷售客戶分散，故較不受單一客戶變動之影響，亦可避免國內殺價競爭及景氣循環對業務之衝擊。
- 國內所有同業廠商中外銷比率最高，除已在成長快速之亞太地區建立行銷管道外，

其他海外銷售據點亦逐年增加中，顯示其頗具國際競爭力。

- D. 全球行銷通路已佈建完成，並獲得國際大廠品質認可。
- E. 可提供客戶從材料至代工之整合性服務。
- F. 以略低於國際領導廠商之價格切入特殊材料市場。

②產品利基

- A. 根據技術發展藍圖規劃新產品之研發、導入及量產時程。
- B. 適時推出市場之主流產品，如阻抗控制多層板、Rambus Module、低介質常數(Low D. K.)基板、Green Laminate 及 RCC Mass Lam 等新產品，以維持獲利之持續成長。
- C. 加強對客戶之服務，滿足客戶少量多樣之需求，並極力配合客戶要求之交期，且積極開拓海外市場。

③技術利基

- A. 1998、1999 及 2001 年分別獲得工業局主導性專案及經濟部科技專案補助，建立完整之產品研發能力。
- B. 具有特殊材料之完整產品組合。

④管理利基

- A. 本公司經營階層在業界皆有十年以上豐富經驗，為專業之經營團隊。
- B. 業務導向之產能規劃維持高產能利用率，增加投資效益。
- C. 扁平組織與精簡之人力保持高度戰鬥力。

(6)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

- A. 現在電子工業和資訊產業持續高速發展，帶動及刺激多層印刷電路板需求成長，玻纖環氧銅箔基板、玻璃纖維膠片及多層壓合基板需求將持續增加。
- B. 我國印刷電路板業產值已居世界第三位，產品品質、價格及交期均受國際肯定，未來發展空間甚具潛力。
- C. 高速網路興起，歐、美、日等國家已相繼建立高速網路，擴大了高品質 PCB 之需求，因此提高了對高性能基板及玻璃纖維膠片的用量。
- D. 本公司之玻璃纖維膠片、銅箔基板及多層壓合基板生產技術已臻成熟，91 年度良率分別提升至 98.72%、98.18%及 96.36%，生產效率不斷提升，陸續完成生產線擴增將可增益其獲利能力。
- E. 公司之經營團隊在此行業中均從事多年相關之工作經驗，且自建廠以來即採用製自動化及嚴格品質控制管理，另更致力於生產技術之提昇及高層次產品之研發，在不斷的努力與投入下，已累積相當實力，對於市場變化及品質要求極具充分因應之能力，並已佔有市場一席之地。
- F. 已取得英國 BSI ISO-9002 及 QS-9000 之品質認證，有助於提升市場競爭力。
- G. 本公司位處位中壢、桃園地區，為印刷電路板業上、下游廠商之集中地，有助於原料之提供，並較易掌握時效。
- H. 本公司產品銷售對象逐漸轉為全球前五十大大廠商，客源分散，較不受國內資訊產業景氣循環之影響，降低營運風險。
- I. 與工研院密切配合，以專案委託方式共同開新產品；1998 年、1999 年及 2001 年分別獲得工業局主導性專案及經濟部科技專案補助，建立完整之產品研發能力。

②不利因素

- A. 環保意識高漲，印刷電路板生產過程中所產生的廢氣、廢水及廢棄物等需妥善地處

- B. 勞工短缺、勞動成本上揚，使業者面臨基層勞工招募不易、人員流動率高及人工成本上漲壓力。
- C. 銅箔基板業看好印刷電路板高度成長所帶來之需求，紛紛擴廠增產，目前國內基板產能擴充迅速，同業競爭壓力增加。
- D. 較低層次的印刷電路板產品，面臨大陸之低成本競爭壓力。
- E. 國內印刷電路板及銅箔基板產能擴張下，但本行業之上游原料銅箔產能擴產不易，導致需求大於供給，上游原料成本上漲壓力不斷增大，使得國內印刷電路板及銅箔基板業皆面臨成本上升壓力。
- F. 本公司產業屬於資本及技術密集之產業，擴充產能極需長期且穩定之資金。
- ③因應之道：
- A. 購買及更新防治污染設備、推動減廢計劃及開發新製程，以符合環保法規之要求，並積極規劃 ISO-14000 環境國際品質認證之通過，另廢棄物均已委由合格廠商代為處理。
- B. 增加自動化生產設備、改善生產流程、降低人力需求及適時引進合法外籍勞工，以增加生產力，並重視員工福利，凝聚員工向心力。
- C. 發展高階(如 High Tg、Low DK、Haloen-Free)及特殊規格基板，並建立行銷網路，成為領先廠商。
- D. 建立完整之經銷服務據點，在未來三年將持續擴充全球據點達 23 處。
- E. 除引進自動化生產設備提昇生產力及產品品質，並積極開發較高層次的產品，另外並透過第三地間接投資大陸，將生產技術層次較低之產品移至大陸生產，以提昇競爭力並且根留台灣。
- F. 本公司積極分散原料來源，不集中向同一供應商採購，以分散風險，另並致力於跟各供應商溝通協調，適時舉辦供應廠商協調會，以穩定原料貨源。
- G. 本公司位處位中壢、桃園地區，為印刷電路板業上、下游廠商之集中地。藉由股票上櫃，以資本市場籌措長期且穩定之資金，使企業得以永續經營且成長茁狀。

## 2. 最近二年度主要產品別毛利率重大變化之說明

單位：新台幣仟元

年度 \ 項目	營業收入淨額	營業成本	營業毛利	毛利率	毛利率變動
90年度	1,346,573	1,128,460	218,113	16.20%	(2.94%)
91年度	1,713,287	1,341,805	371,482	21.68%	33.83%

註：毛利率變化之價量分析，詳附件一。

## 二、固定資產及其他不動產

(一)本公司及子公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止之重大資產買賣情形(交易金額達實收資本額百分之二十或三億元以上之資產)

1. 本公司取得與處分重大資產情形：無。
2. 子公司取得與處分重大資產情形：無。

### 三、轉投資事業

#### (一) 轉投資事業概況

##### 1. 轉投資事業概況：

91年12月31日；單位：新台幣仟元；仟股

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	91年度		持有公 司股 份額
				股數	股權比例				投資損	報酬 分配 股利	
邦茂投資(股)公司	投資業	19,940	30,262	1,994	99.70%	30,262	--	權益法	--	--	--
EVER SMART INTERNATIONAL CO., LTD.	投資控股	122,024	111,601	3,500	70.00%	111,601	--	權益法	(10,418)		--
ITEQ TECHNOLOGY CO., LTD.	投資控股	3,458	(1,283)	--	100.00%	(1,283)	--	權益法	(1,293)		--
利碟(股)公司	電子零組件製造	13,143	13,143	380	0.10%	--	3,169	LCM法	--	--	--
佳鼎科技(股)公司	印刷電路板製造	49,725	49,725	1,369	0.61%	--	11,221	LCM法	--	--	--
邦利國際科技(股)公司	電子零組件製造	2,050	2,050	205	2.47%	472	--	成本法	--	--	--
永剛科技(股)公司	鋁箔及容器製造	5,000	5,000	270	0.44%	2,657	--	成本法	--	--	--
普羅米數位科技(股)	電子材料批發	500	500	50	1.43%	207	--	成本法	--	--	--
隴邦科技(股)公司	電子材料批發	500	500	50	10.20%	412	--	成本法	--	--	--
邦英生物科技(股)公司	生物科技	1,000	1,000	100	5.00%	550	--	成本法	--	--	--

2. 對轉投資事業具有重大影響力者，被投資公司利用本公司資源及技術之情形：無。

3. 對轉投資事業具有控制能力者，最近年度與本公司進、銷貨交易、授信政策、交易條件、款項收回之情形：

本公司基於成本考量及三角貿易型態需要，自91年12月起透過ESIC向東莞聯茂採購低階台灣並未生產之銅箔基板及多層壓合基板等產品，由於係屬三角貿易性質，且報關費、運費等出口至第三地之費用均由對方負擔，故進貨價格按本公司銷貨價格之97.5%計算，付款期間則為月結90天，與非關係人相較並無重大異常，且進貨金額不大，僅占91年總進貨金額比率之1.07%。

單位：新台幣仟元

91年12月31日

公司名稱	交易情形						交易條件與一般交易不同之情形及原因		應付(收)帳款、票據		逾期應收款項		應收款項後收回金額	備抵呆帳金額	備註
	進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率	銷貨毛利	單價(元/張)	授信期間	單價(元)	授信期間	餘額	佔總應付(收)帳款、票據之比率	金額	處理方式			
ESIC	進貨	11,280	2.66%	--	169.35	月結90天	--	--	11,280	7.9%	--	--	--	--	--

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及設定質權之情形

最近二年度本公司之子公司中僅邦茂投資(股)公司曾取得及處分本公司股權情形，邦茂公

司主係就本公司未來獲利前景等進行評估後以自有資金取得本公司股份，惟91年4月底前邦茂公司已出售全部持股，且目前並未持有本公司股票。故對於公司之經營結果及財務狀況不致產生影響。

單位：新台幣仟元；股；%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年底或公開說明書刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書金額	本公司貸與子公司金額
邦茂投資(股)公司	20,000	自有資金	99.70%	90年度	2,284股(註1) 6仟元	-	-	10,284股 146仟元	-	-	-
				91年度	415,243股 4,427仟元	425,527股(註2) 4,255仟元	(318)	-	-	-	
				截至92年公開說明書刊印日止	-	-	-	-	-	-	

註1：90年期初邦茂公司持有本公司8,000股，期中取得383股，取得金額6仟元，並因無償配股取得1,901股，故90年期末持有股數為10,284股。

註2：91年期初邦茂公司持有本公司10,284股，期中再取得415,243股，全數於91年4月底前處分完畢。

#### 四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
主導性新產品開發計劃	經濟部工業局	90.09.01~91.12.31	主導性新產品開發計劃補助款合約書	產品開發完成後，本公司因本計畫所取得之配合款及應繳納之回饋金未全數繳還行政院開發基金前，非經工業局同意，不得移往台灣地區境外生產。
主導性新產品開發計劃	交通銀行	90.09.01~91.12.31	鼓勵民間事業開發工業新產品計劃開發費用配合款	
產品開發研究	工研院化工所	90.09.01~91.12.31	通訊基板用快速硬化樹脂配方開發研究契約書	
土地買賣合約	鍾興來等五人	91/04/14	購買廠區附近之土地	無
合資協議書	海外投資開發公司等四人	91/04/03~全體當事人書面同意終止本協議或ESIC向主管機關提出股票上市或上櫃申請通過止	ESIC辦理現金增資，並由聯茂電子公司及海外投資開發公司等共五人參與投資	註
長期借款	交通銀行	88/08~93/11	新建廠房及設備	無
長期借款	交通銀行	89/11~94/11	新建廠房	無
長期借款	交通銀行	89/05~92/02	經濟部工業局配合款	無
長期借款	交通銀行	91/12~95/12	經濟部工業局配合款	無
長期借款	交通銀行	91/11~97/11	營運週轉金	無
長期借款	中華開發銀行	89/08~94/08	購買土地及廠房設備	無
長期借款	中華開發銀行	91/12~93/01	營運週轉金	無
長期借款	新竹商業銀行	90/05~93/05	購置土地及廠房設備	無

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款	台灣企銀	91/08~106/08	營運週轉金	無
長期借款	台灣企銀	91/08~96/08	營運週轉金	無

註：

1. 該協議書任一當事人非經其他全體當事人事先以書面同意，不得將ESIC公司之股份及與股份有關之任何權利出售、移轉、質押、或設定其他負擔或處分予任何第三人。
2. 本公司不得將其持有之ESIC公司之股份出售、轉讓予任何第三人。

## 五、營運概況其他必要補充說明事項

### (一) 訴訟或非訟事件

1. 公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司88年期間因未取得廢水排放許可證且經環保署取樣廢水檢測認定排放廢水超過排放標準，環保署除依水污染防治法處以公司罰金新台幣十二萬元外；另依水污染防治法第三十四條及第三十七條將本公司移送法辦，該案於91年2月22日經台灣桃園地方法院判決無罪，環保署雖續向高等法院再提上訴，惟根據桃園地方法院之判決理由略以：環保署稽查員所施行之採樣過程因未遵循法定保存程序，其檢測結果自不能充分證明本公司排放廢水超過放流水標準，故不能斷定為有罪；另本公司亦已於88年10月取得排放許可。綜上，本案經桃園地方法院偵查並無其他積極之證據足資證明本公司有違反水污染防治法之不法犯行，縱若高等法院判決本公司有罪，則本公司依當時水污染防治法第三十七條規定須被課以新台幣三萬元以下罰金，對公司財務影響甚微，故訴訟案結果對股東權益或證券價格應無重大不利影響。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十以上之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司法人董事寰邦投資股份有限公司之代表人林邦充於88年間因利碟公司申請上市期間遭舉發(時任利碟公司董事長)，被控其涉有侵佔及背信情事乙案，於91年6月28日經台北地方法院檢察署檢查官偵查完畢並為不起訴處分，而該檢查署依職權送請台灣高等法院檢察署再議，亦同為不起訴之處分。

另88年期間本公司因未取得排放許可證且排放廢水超過排放標準而遭環保署提起訴訟一案，林邦充當時擔任本公司董事長為法定負責人，遂一併被指控違反水污染防治法，該案於91年2月22日經台灣桃園地方法院判決無罪，環保署雖續向高等法院再提上訴，惟根據律師意見認為林邦充董事非該污染事件業務之實際負責人，應不必負擔該部分刑責。由於林邦充先生目前並未擔任本公司董事長，僅為本公司法人董事之代表人，公司整體營運亦不致受到影響。

此外，本公司法人董事和通創業投資股份有限公司89年間因參與志同積體電路股份有限公司所辦理之第一次現金增資，於繳納股款後，志同公司卻於同年經董事會決議中止辦理該次現金增資，隨後僅退還該公司部分股款，經該公司屢次追討無效後，於91年3月正式向台北地方法院申請支付命令，並順利於同年5月取得法院「支付命令確定證明書」，據以追索志同公司債務，目前全案已進入債務清償之強制執行階段。

3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十以上之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及目前辦理情形：無。



## 參、發行計畫及執行情形

### 一、本次發行公司債資金運用計畫分析

#### (一) 資金來源

##### 1. 的事業主管機關核准日期及文號：

財政部證券暨期貨管理委員會民國九十二年六月十九日台財證一字第○九二○一二七二四六號函。

##### 2. 計畫所需資金總額：新台幣100,000 仟元。

##### 3. 資金來源：發行九十二度第一次有擔保普通公司債新台幣100,000元。

#### (二) 本次發行公司債應依公司法248 條之規定，揭露有關事項：

##### 1. 公司九十二度第一次有擔保普通公司債發行辦法

(1) 債券名稱：聯茂電子股份有限公司九十二度第一次有擔保普通公司債( 下稱「本公司債」)

(2) 發行總額：發行總額為新台幣壹億元整。

(3) 票面金額：新台幣壹佰萬元整壹種，共壹佰張。

(4) 發行期間：發行期間為五年。

(5) 保證銀行：由交通銀行股份有限公司保證發行。

(6) 發行價格：依本公司債面額十足發行。

(7) 票面利率：利率為1.35%。

(8) 付息方式：自發行日起，每年依票面利率單利計、付息一次。

(9) 還本方式：於發行後屆滿三、四、五年分別還本30%、30%、40%。

(10) 債券形式：

無記名式，並附有本息票。持有人(含承購人)得隨時申請為記名式。債券若有遺失、被盜或毀損，持有人得依相關法律規定辦理掛失止付，於完成所有相關法定程序後，申請補發債券，申請補發債券所發生之費用，由申請人自行負擔。

(11) 償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

本公司將以每年營運所產生之資金償還之，並依代理還本付息合約之規定，於還本付息日前一個營業日交付還本付息代理機構交通銀行股份有限公司以備兌付到期本金、利息。

(12) 公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款

(13) 受託人：

由萬通商業銀行總行信託部為債權人之受託人，代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行公司債發行事項之權責，並訂定受託契約。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途受讓者，對於受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法，均予承認並

同意授與有關受託事項之全權代理，此授權並不得中途撤銷。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

(14)前募集公司債者，其未償還之數額：發行國內第一次無擔保轉換公司債，新台幣200,000仟元。

(15)公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣974,969仟元(至92年3月31日)。

2. 託經財政部證券暨期貨管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等，應揭揭露信用評機構所出具之信用評等報告：無

(三)本次計畫之可行性、必要性及合理性，及各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響

1. 可行性、必要性、合理性

(1)可行性

本公司債採未委託證券承銷商對外公開承銷方式，限洽特定人認購，募集完成可行性高。

(2)必要性

考量目前市場利率水準相對偏低，為避免未來利率走揚衍生資金成本增加，本次發行公司債用以固定長期資金成本，以節省利息支出。

(3)合理性

預期未來利率將逐漸上揚，為避免資金成本的增加，本公司發行公司債償還部分短期借款以節省利息支出應屬合理。

2. 本次公司債對公司申報(請)年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

本次發行有擔保公司債不影響公司股權稀釋。

(四) 資金運用概算及可能產生效益

1. 債務償還計畫及預計財務負擔減輕情形分析表

單位：新臺幣千元

貸款機構	利率(%)	契約期間	原貸款用途	原貸款金額	92 年度				93 年度				合計	
					第 三 季		第 四 季		第 一 季		第 二 季			
					償還金額	減少利息	償還金額	減少利息	償還金額	減少利息	償還金額	減少利息	償還金額	減少利息
中華開發	4.2	91.12.5 至 93.1.5	短期週轉	50,000	50,000	356		356		20			50,000	732
大眾銀行	4.0	92.3.1 至 93.2.29	短期週轉	21,418	20,000	133		133		87			20,000	353
台灣工銀	3.8	92.4.15 至 93.4.14	短期週轉	30,000	30,000	184		184		184		28	30,000	580
合計				101,418	100,000	673		673		291		28	100,000	1,665

註：本次發行公司債用以償還借款所減少之利息，係擬定 92 年 7 月 1 日為預計還款日，並以節省之利率(原貸款利率減去公司債發行利率 1.35%)計算而得。

◎所需資金之預計運用情形、公司債務逐年到期金額及償還計畫

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度			
			九十二年度			
			第一季	第二季	第三季	第四季
償還銀行借款	92 年第三季	100,000			100,000	

◎公司申報年度及未來年度各月份之現金收支預估表：請參閱本文第 35 頁~第 3 頁。

(1)92年1-12各月份現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目／月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
期初現金餘額(1)	111,371	138,120	174,720	179,079	117,412	206,969	191,784	235,864	169,785	154,483	300,416	230,300	
加：非融資性收入(2)													
應收款項收現(銷貨收現)	152,639	163,916	151,867	154,459	160,884	175,633	175,691	194,167	197,706	205,262	205,324	201,770	2,139,318
處分固定資產						19,770			19,769				39,539
利息及其他收入	5,417	2,412	719	715	715	715	715	715	715	715	715	715	14,983
合計	158,056	166,328	152,586	155,174	161,599	196,118	176,406	194,882	218,190	205,977	206,039	202,485	2,193,840
減：非融資性支出(3)													0
應付款項付現	20,358	16,468	16,179	16,110	16,967	16,434	17,913	18,203	18,805	20,654	20,872	23,484	222,447
購料付現	142,382	110,562	119,193	130,205	139,052	138,102	138,282	135,327	150,440	163,722	153,142	161,989	1,682,398
薪資付現	13,023	14,412	12,412	12,412	12,412	12,412	12,412	12,413	12,413	12,416	12,414	12,420	151,571
長期投資			6,900			15,555		6,900	23,115		18,975	20,010	91,455
固定資產			8,940	9,100	9,100	9,674	9,593	9,594	9,593	9,126	9,127	9,127	92,974
董監酬勞及員工紅利								8,169					8,169
買回庫藏股			9,093	15,907							(12,500)		12,500
利息及其他支出	3,804	3,546	3,770	3,770	3,770	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	3,386	42,362
合計	179,567	144,988	176,487	187,504	181,301	195,563	181,586	193,993	217,752	209,304	205,415	230,416	2,303,876
要求最低現金餘額(4)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	--
所需資金總額(5)=(3)+(4)	249,567	214,988	246,487	257,504	251,301	265,563	251,586	263,992	287,752	279,304	275,415	300,416	--
融資前可供支用現金餘額 (短絀)(6)=(1)+(2)-(5)	19,860	89,460	80,819	76,749	27,709	137,524	116,604	166,754	100,223	81,156	231,040	132,369	--
融資淨額(7)													
發行可轉債										200,000			200,000
發行普通公司債							100,000						100,000
借款	132,000	44,000	80,000										256,000
償債	(83,740)	(28,740)	(51,740)	(29,337)	(90,740)	(15,740)	(50,740)	(50,740)	(15,740)	(50,740)	(70,740)	(50,742)	(589,479)
現金股利								(16,229)					(16,229)
合計	48,260	15,260	28,260	(29,337)	109,260	(15,740)	49,260	(66,969)	(15,740)	149,260	(70,740)	(50,742)	100,292
期末現金餘額8=1+2-3+7	138,120	174,720	179,079	117,412	206,969	191,784	235,864	169,785	154,483	300,416	230,300	151,627	

註：期末現金餘額與預估現金流量分析表所列之期末現金餘額如有差異時，應說明差異原因：無。

(2)93年1-12各月份現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目 / 月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
期初現金餘額(1)	151,627	105,234	97,390	95,223	107,085	96,697	91,033	99,200	84,769	95,239	103,925	89,577	
加：非融資性收入(2)													
應收款項收現	196,021	197,015	196,498	192,216	189,155	196,051	197,289	202,409	211,545	215,653	216,487	214,824	2,425,163
利息及其他收入	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
合計	197,021	198,015	197,498	193,216	190,155	197,051	198,289	203,409	212,545	216,653	217,487	215,824	2,437,163
減：非融資性支出(3)													
應付款項付現	21,376	17,291	16,988	16,916	17,815	17,256	18,809	19,113	19,745	21,687	21,916	24,658	233,569
購料付現	138,805	135,090	135,153	136,715	136,005	140,757	145,946	153,093	157,962	161,908	166,549	168,535	1,776,518
薪資付現	14,325	15,853	13,653	13,653	13,653	13,653	13,653	13,654	13,654	13,658	13,655	13,662	166,728
長期投資			15,000			17,400							32,400
固定資產	7,733	7,733	7,734	2,933	2,933	2,934	1,000						33,000
利息及其他支出	4,184	3,901	4,147	4,147	4,147	3,725	3,725	5,989	3,725	3,725	3,725	3,725	48,863
合計	186,424	179,868	192,675	174,364	174,554	193,725	183,132	191,849	195,086	200,977	205,845	210,580	2,291,078
要求最低現金餘額(4)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	
所需資金總額(5)=(3)+(4)	266,424	259,868	272,675	254,364	254,554	275,725	263,132	271,849	275,086	280,977	285,845	290,580	
融資前可供支用現金餘額 (短絀) (6)=(1)+(2)-(5)	82,224	43,380	21,213	34,075	42,687	18,023	26,190	30,759	22,229	30,915	35,567	41,821	
融資淨額 (7)													
借款													
償債	(56,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,900)	(6,989)	(209,879)
合計	(56,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,990)	(6,990)	(6,990)	(25,900)	(6,989)	(209,879)
期末現金餘額 8=1+2-3+7	105,234	97,390	95,223	107,085	96,697	91,033	99,200	84,769	95,239	103,925	89,577	87,832	

2. 就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款及應付帳款付款政策、資本支出計劃、財務槓桿及負債比率(或自有資產與風險性資產比率)，說明償債之原因：
  - (1) 本次發行公司債係以償還借款、改善財務結構，並節省利息支出、降低財務風險，因此，對本公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款政策、應付帳款付款政策及資本支出計劃並無影響。
  - (2) 本公司為確保公司未來經營的穩定性與債權的安全性，並維持資金較佳流動性，本公司仍將維持目前之應收帳款收款政策。本公司應付帳款付款政策主係考量市場環境、購買數量、同業價格、貨源供應、貨源品質等因素，來訂定適切的應付帳款付款政策。
3. 申報年度及預計未來一年度預估財務結構及償債能力分析：

本次發行公司債取得所需資金，用以償還資金成本較高之借款，因利息支出節省，財務槓桿比率稍微降低，負債比率則維持不變，預估未來年度之流動比率及速動比率，將比前一年增加，資金運用將能更加彈性充裕，以備未來業務發展所需。

## 肆、財務概況

### 一、最近五年度簡明財務資料

#### 財務分析

分析項目		最近五年度財務資料(註1)					當年度截至 92年03月31日
		87年	88年	89年	90年	91年	
財務結構 (%)	負債占資產比率	72	58	68	57	59	62
	長期資金占固定資產比率	92	107	96	104	156	152
償債能力 (%)	流動比率	72	91	87	88	144	128
	速動比率	57	73	70	70	119	103
	利息保障倍數	(1)	3	2	1	3	3
經營能力	應收款項週轉率(次)(註3)	3.74	4.66	3.69	3.79	3.72	3.47
	平均收現日數	98	78	99	96	98	105
	存貨週轉率(次)	9.04	11.60	8.55	8.07	8.33	8.02
	應付款項週轉率	7.32	14.94	25.23	22.35	23.58	3.89
	平均銷貨日數	40	31	43	45	44	46
	固定資產週轉率(次)	0.55	1.53	1.14	1.26	1.68	2.12
	總資產週轉率(次)	--	--	0.62	0.74	0.72	0.83
獲利能力	資產報酬率(%)	(3)	8	8	4	6	5
	股東權益報酬率(%)	(12)	16	19	5	9	10
	占實收資本比率%						
	營業利益	(18)	23	15	9	18	12
	稅前純益	(19)	18	7	4	13	12.56
純益率(%)	(11)	6	9	3	5	4.27	
	每股盈餘(元)(註2)	(0.94)	1.32	1.87	0.50	1.03	0.28
現金流量	現金流量比率(%)	註	37	註	3	8	註
	現金流量允當比率(%)	註	註	註	註	3	-
	現金再投資比率(%)	註	22	註	2	3	-
槓桿度	營運槓桿度	0.63	1.51	2.38	1.98	1.51	3
	財務槓桿度	0.75	1.60	2.01	6.14	1.52	2

註：營業活動淨現金流量為負數。

註1：87~91年度財務資料均經會計師查核簽證。

註2：各年度之每股盈餘係以當年度加權平均流通在外股數計算。

註3：財務分析之計算公式如下：

## 1.財務結構

(1)負債占資產比率=負債總額／資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)／固定資產淨額。

## 2.償債能力

(1)流動比率=流動資產／流動負債。

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)／流動負債。

(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

## 3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數=365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率=銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均售貨日數=365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率=銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率=銷貨淨額／資產總額。

## 4.獲利能力

(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用\*(1-稅率)]／平均資產總額。

(2)股東權益報酬率=稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率=稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)／加權平均已發行股數。

## 5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。

(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)／(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)。

## 6.槓桿度：

(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度=營業利益／(營業利益-利息費用)。



## 二、財務報表

- (一)最近兩年度財務報表及會計師查核報告：參第53頁。
- (二)92年度經簽證會計師核閱之財務預測：參第41頁。
- (三)最近一年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表：參第63頁。
- (四)截至公開說明書刊印日前之最近期經會計師查核簽證之財務報表：無。

(五)最近三年度財務預測達成情形：

單位：新台幣仟元

項 目	89年度			90年度			91年度			92年度
	原預測數 —	實際		原預測數 —	實際		原預測數 (91/05/03) (91/05/18)	實際		原預測數 (92/3/17) (92/3/25)
		達成數	達成率 (%)		達成數	達成率 (%)		達成數	達成率 (%)	
營業收入	—	—	—	—	—	—	1,791,023	1,713,287	95.66	2,383,206
營業成本	—	—	—	—	—	—	1,400,044	1,341,805	95.84	2,018,365
營業毛利	—	—	—	—	—	—	390,979	371,482	95.01	364,841
營業費用	—	—	—	—	—	—	204,902	225,129	109.87	220,703
營業利益	—	—	—	—	—	—	186,077	146,353	78.65	144,138
營業外收入	—	—	—	—	—	—	15,650	31,367	200.43	33,104
營業外支出	—	—	—	—	—	—	85,966	75,425	87.74	53,417
稅前純益(損)	—	—	—	—	—	—	115,761	102,295	88.37	123,825
稅後純益	—	—	—	—	—	—	77,563	81,693	105.32	101,636
每股盈餘	—	—	—	—	—	—	0.96元	1.03元	107.29	1.22元

註1：各年度之每股盈餘係以當年度加權平均流通在外股數計算。

註2：括弧內日期分別為財務預測編製完成及公告日期。

### 1.91年度財務預測達成情形

單位：新台幣仟元

項目	91年度財務預測 (經簽證會計師核閱)	91年度經會計師查核簽證之報表	
		達成金額	達成%
營業收入	1,791,023	1,713,287	95.66
營業成本	1,400,044	1,341,805	95.84
營業毛利	390,979	371,482	95.01
營業費用	204,902	225,129	109.87
營業利益	186,077	146,353	78.65
營業外收入	15,650	31,367	200.43
營業外支出	85,966	75,425	87.74
本期稅前純益	115,761	102,295	88.37

本公司 91 年財務預測係於 91 年 5 月 3 日編製完成。斯時各界原本樂觀預期 2002 年全球經濟景氣將明顯復甦並進而帶動 PCB 等電子通訊產品需求回溫，然市況並未完全如預期，加之第四季美伊局勢緊張，開戰陰影籠罩，市場瀰漫不安與悲觀氣氛，消費者信心滑落，需求陷入膠著，致景氣復甦腳步遲緩，本公司玻璃纖維膠片、銅箔基板之銷量及售價因而均較預期減少，多層壓合基板之售價亦下跌近 9%，所幸因新客戶開發成效顯現，多層壓合基板之銷量較預期超出 21.40%，致全年營業收入及營業毛利仍達成 95.66% 及 95.01%，營業費用則因外銷出口費用增加、申請上櫃作業及增聘研發人員等因素而超出預測數，故在毛利減少而營業費用增加之雙重影響下，營業利益遂僅達成財測數之 78.65%。營業外收入方面，由於下腳收入、供應商及加工廠支付之理賠收入及各項退稅款較預期增加致達成率較高；另因利息支出及存貨報廢損失較預期減少，故營業外支出少於預測數 10,541 仟元。綜上，稅前純益達成目標數之 88.37%，差異 13,466 仟元，應尚屬合理，且相較於同業調降財測情形，財測達成應屬良好。

### 同業九十一年度財測更新情形

單位：新台幣仟元

公司	台光電			合正		華韜	
	原財測 (91.4.29)	更新財測 (91.9.20) (降幅)	二次更新財測 (91.12.31) (降幅)	原財測 (91.4.29)	更新財測 (91.9.20) (降幅)	原財測 (91.4.29)	更新財測 (91.9.20) (降幅)
營業收入	1,669,868	1,375,362 (17.64%)	1,317,736 (21.09%)	2,187,135	1,792,802 (18.03%)	1,572,680	1,135,177 (27.82%)
營業毛利(損)	248,314	178,311 (28.19%)	124,329 (49.93%)	143,211	172,699 (-20.59%)	290,417	168,877 (41.85%)
營業(損)益	130,783	61,986 (52.60%)	15,640 (88.04%)	11,514	19,897 (-72.81%)	180,668	102,979 (43.00%)
稅前(損)益	49,950	(73,530) (247.21%)	(124,541) (349.33%)	148,294	(28,729) (119.37%)	176,600	90,173 (48.94%)

註1：括弧內日期為財務預測編製日期。

註2：降幅係以原財測為比較基礎。

### 三、財務概況其他重要事項應記載事項

(一)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者：無。

### 四、財務狀況及經營結果之檢討與分析，並說明風險管理情形

(一)財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

財務狀況比較分析表

項目	年度	91 年度	90 年度	差 異	
				金額	%
流動資產		1,157,656	624,642	533,014	85.33
長期股權投資		164,540	51,927	112,613	216.87
固定資產		1,021,773	1,072,318	(50,545)	(4.71)
其他資產		49,720	79,845	(30,125)	(37.73)
資產總額		2,393,689	1,828,732	564,957	30.89
流動負債		802,137	712,378	89,759	12.60
長期負債		620,535	322,463	298,072	92.44
其他負債		1,399	3,790	(2,391)	(63.09)
負債總額		1,424,071	1,038,631	385,440	37.11
股本		811,440	711,440	100,000	14.06
資本公積		71,010	71,010	0	0
保留盈餘		149,539	73,596	75,943	103.19
未實現長期股 權投資跌價 損失		(61,756)	(65,618)	3,862	5.89
累積換算調整		(615)	(327)	288	88.07
股東權益總額		969,618	790,101	179,517	22.72

註1：%指該科目於各相關報表之同型比率

註2：%指以前一年度為100%所計算出之變動比率

## 會計科目重大變動說明

單位：新台幣仟元

會計科目	91 年度(註 1)		90 年度(註 1)		增 減 變 動 (註 2)		說 明
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
現金及銀行存款	111,371	4.65	59,683	3.26	51,688	86.60	營運規模成長，現金流入及借款增加所致。
應收票據	84,537	3.53	34,786	1.90	49,751	143.02	營業額成長所致。
應收帳款	409,190	17.09	247,286	13.52	161,904	65.47	營業額成長所致。
應收帳款—關係人	52,970	2.21	22,617	1.24	30,353	100.00	對上賦國際貿易之帳款增加所致。
其他應收款—關係人	95,751	4.00	--	0.00	95,751	100.00	對 ESIC 之帳款增加所致。
存貨	198,978	8.31	123,318	6.74	75,660	61.35	91 年產銷增加，致存貨亦隨之增加。
受限制存款	39,590	3.74	39,600	2.17	49,990	126.24	係因質押定存增加所致。
長期股權投資	164,540	6.87	51,927	2.84	112,613	216.87	增加對 ESIC 之投資所致。
累計折舊	206,362	12.04	137,748	10.23	68,614	49.81	因增購機器設備及逐年攤提折舊，致累計折舊攀升
其他資產	49,720	2.90	79,845	5.93	(30,125)	(37.73)	遞延所得稅減少。
一年內到期之長期借款	28,862	1.69	100,983	7.50	(72,121)	(71.40)	因償還交通銀行之長期借款所致。
應付票據	234,114	13.68	83,261	6.18	151,053	181.42	產銷量增加，購料之應付票據亦隨之增加。
應付帳款	190,326	11.11	124,807	9.27	65,519	52.50	因 91 年第四季產銷暢旺，備料增加所致。
長期借款	620,535	36.22	322,463	23.95	298,072	92.44	支應購置固定資產之資金需求所致。
股本	811,440	47.36	711,440	52.83	100,000	14.06	係因現金增資所致。
累積盈餘	130,343	7.61	57,605	4.28	72,538	125.92	獲利增加所致
銷貨收入	1,775,130	103.61	1,375,538	102.15	399,592	29.05	開發國外銷售據點且積極拓展客源所致。
銷貨收入淨額	1,713,287	100.00	1,346,573	100.00	366,714	27.23	開發國外銷售據點且積極拓展客源所致。
營業毛利	371,482	21.68	218,113	16.20	153,369	70.32	係 91 年銷貨增加所致。
推銷費用	128,015	7.47	84,292	6.26	43,723	51.87	因外銷收入增加致出口費用、佣金支出亦增加。
營業淨利	146,353	8.54	64,754	4.81	81,599	126.01	毛利增加所致。
投資損失	16,313	0.95	5,035	0.37	11,278	223.99	轉投資事業尚屬初期未有獲利產生及認列被投資公司之減資損失所致。
稅前淨利	102,295	5.97	30,037	2.23	72,258	240.56	主係營業淨利增加。
所得稅費用	20,602	1.20	(4,009)	(0.30)	24,611	(613.89)	主係稅前淨利增加及投資抵減金額減少所致。
稅後淨利	81,693	4.77	34,046	2.53	47,647	139.95	主係營業淨利增加。

註 1：%指該科目於各相關報表之同型比率

註 2：%指以前一年度為 100%所計算出之變動比率

(二)經營結果：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫

1. 經營結果比較分析

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	91 年度	90 年度	增(減)金額	變動比例%
營業收入總額	1,775,130	1,375,538	399,592	29
減：銷貨退回	20,603	1,218	19,385	1,592
銷貨折讓	41,240	27,747	13,493	49
營業收入淨額	1,713,287	1,346,573	366,714	27
營業成本	1,341,805	1,128,460	213,345	19
營業毛利	371,482	218,113	153,369	70
營業費用	225,129	153,359	71,770	47
營業利益	146,353	64,754	81,599	126
營業外收入及利益	31,367	35,564	(4,197)	(12)
營業外費用及損失	75,425	70,281	5,144	7
繼續營業部門稅前淨利	102,295	30,037	72,258	241
所得稅費用	20,602	(4,009)	24,611	(614)
繼續營業部門稅後淨利	81,693	34,046	47,647	140

增減比例變動分析說明：

1. 營業收入總額增加，主要係本年度開發國外銷售據點，且積極拓展國內客源所致。
2. 銷貨退回增加主要係本公司原新加坡代理商 UCHEM，轉移為本公司之外倉，故將原銷售給 UCHEM 之產品退回移轉為本公司之存貨。
3. 銷貨折讓增加主要係本公司為提昇應收帳款回收速度，提供予客戶收現之折讓金額政策。
4. 營業費用增加，主要係出口費用、佣金支出隨外銷收入增加及出口次數增加而上升，手續費因本期公司上興櫃及掛牌上櫃而增加所致。
5. 營業外收入及支出變動原因如下：
  - (1) 利息收入因本期銀行存款利率大幅下降而減少。
  - (2) 兌換利益淨額減少，主要係去年同期台幣匯率持續走貶，使出口外銷之兌換利益增加，而本期匯率波動不致太大，使兌換利益減少。
  - (3) 投資損失增加主係本年度轉投資東莞聯茂，尚屬建廠初期未產生淨利

，及認列被投資公司之減資損失所致。

6. 所得稅費用增加係因本年度稅前淨利增加及投資抵減金額減少所致。

7. 綜上所述，致使本期稅後淨利較上年度增加。

## 2. 營業毛利變動分析

單位：新台幣千元

	前後期 增(減) 變動數	差異原因			
		售價 差異	成本價 格差異	銷售組 合差異	數量 差異
黏合片	\$ 6,006	(49,188)	49,286	9	5,899
基板	66,840	(68,790)	89,938	13,504	32,188
多層印刷電路板	80,523	(50,014)	68,227	9,531	52,779
合計	\$ 153,369	(167,992)	207,451	23,044	90,866

1. 售價差異：本期因市場競爭激烈，主要銷售產品其單價皆下降，產生不利售價差異，致使毛利下降。

2. 成本價格差異：本期因原料價格下降，加上產能利用率提高，致單位成本下降，產生有利成本價格差異，而使毛利增加。

3. 銷售組合差異：因本期銷售技術層次較高、毛利率較高之產品比重增加，故產生有利之組合差異，致毛利增加。

4. 數量差異：主要因本期業務持續擴展，致銷售量提升，故產生有利之差異。

## (三)最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析

### 1. 最近(91)年度現金流量分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現金不敷措施	
				投資計劃	理財計劃
59,683	61,372	9,684	111,371	-	-

### 2. 未來一年現金流量性分析

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流出量	現金剩餘(不足)數額	現	金	不	足	額
				之	補	救	措	施
				投資計劃		理財計劃		
111,371	51,241	60,986	101,626	-			-	

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：無。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司最近年度之轉投資政策為評估與公司現在及未來有相關業務，或對本公司業務發展有正面助益之公司進行轉投資，目前部份轉投資公司大多因處於成立初期，獲利能力尚未顯現，當轉投資公司業務逐漸步上軌道之後，應能順利轉虧為盈。

(六)風險管理應分析評估下列事項：

1、最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

利率持續下滑，降低本公司資金成本；國內景氣受全球經濟不景氣影響，91年度並無通貨膨脹情形；雖然新台幣走勢全年度呈貶值趨勢，本公司因應得宜，並未影響本公司的獲利。



## 伍、特別記載事項

### 一、內部控制制度執行狀況：

#### (一)最近三年度會計師提出之內部控制建議及其改善情形

年度	會計師建議意見	目前改善情形
89年度	無	—
90年度	無	—
91年度	無	—

(二)最近三年度內部稽核發現之重大缺失改善情形：無。

(三)會計師內部控制專案審查報告：無。

二、信用評等機構出具之信用評等報告：無。

三、證券承銷商評估總結意見：無。

四、律師法律意見書：無。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：請詳本文第68頁。

六、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經證期會通知應補充揭露之事項：無。

七、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

八、最近年度及截至公開說明書刊印日止，本公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施：請參閱本文第49頁。

上市（櫃）公司治理運作情形及其改善計畫或因應措施

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
一、公司治理架構及原則					
(一) 公司是否建置公司治理制度並涵蓋主要治理原則	是	本公司按公司法及證期會之各項規範，制度公司章程、制度及各項辦法，多已實現公司治理之主要精神與原則。			
(二) 公司是否建立完備之內部控制制度並有效執行	是	依各交易循環劃分各作業層級，分別建立及執行內控、內稽及自行檢查作業並出具內控聲明書。			
二、公司股權結構及股東權益					
(一) 公司是否訂有股東會議事規則	是	已刊於每年的股東會議事手冊中。			
(二) 公司是否設有專責人員處理股東建議或糾紛等問題	是	專人負責，如涉及法律問題，會轉洽公司法律顧問處理。			
(三) 公司是否隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單	是	與主要股東關係良好，可隨時聯絡。			

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(四)公司是否揭露主要股東有關質押、增加或減少公司股份等重要事項	是	已依規定由本公司股務代理申報。			
(五)公司與關係企業是否建立適當風險控管機制及防火牆	是	已訂定子公司監理辦法執行之			
三、董事會結構及獨立性					
(一)公司是否設置二席以上獨立董事	是	本公司已同時選任獨立董事二人及獨立監察人一人。			
(二)公司董事會是否設審計委員會	否		研議中	視實際需要研議辦理	
(三)公司董事長、總經理是否由不同人擔任，或是否無配偶或一等親之關係	是	本公司採專業經理人制度，權責清楚，各盡職責。			
(四)董事對於有利害關係議案之迴避是否確實執行	是	自動迴避為基本共識。			
四、董事會及經理人之職責					
(一)公司是否訂有董事會議事規則	否		研議中	視實際需要研議辦理	
(二)公司是否訂定各專門委員會行使職權規章	否		由各單位主管依權責負責各項職能之控管。	公司視現況需要再行設置。	
(三)公司董事會是否定期評估簽證會計師之獨立性	是	每年評估			

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(四) 公司是否有為董事購買責任保險	否		研議中	已與保險公司洽談中	
(五) 公司是否訂有董事進修制度	否		研議中	視實際需要研議辦理	
五、監察人之組成、職責及獨立性					
(一) 公司是否設置一席以上獨立監察人	是	本公司已同時選任獨立董事二人及獨立監察人一人。			
(二) 監察人與公司之員工、股東及利害關係人是否建立溝通管道	是	有需要隨時皆可藉由電話、E-MAIL聯絡。			
(三) 公司是否成立監察人會並訂定議事規則	否		研議中	視實際需要研議辦理	
(四) 公司是否有為監察人購買責任保險	否		研議中	已與保險公司洽談中	
(五) 公司是否訂有監察人進修制度	否		研議中	視實際需要研議辦理	
六、利害關係人之權利及關係					
(一) 公司是否建立與利害關係人之溝通管道	是	有需要隨時皆可藉由電話、E-MAIL聯絡。			
(二) 公司是否重視公司之社會責任	是	本公司守法守分重視勞資關係；提供就業機會，善盡社會責任。			
七、資訊公開					

項目	是否已執行	簡述執行情形	未執行之原因	改善計畫或因應措施	備註
(一) 公司是否指定專人負責公司資訊蒐集及揭露工作，	是	有專人收集資訊，發言人及專人上網資訊揭露。			
(二) 公司是否建立發言人制度	是	已設置			
(三) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊	否		研議中	視實際需要研議辦理	
八、其他應揭露事項：無					

## 聯茂電子股份有限公司財務報表會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司董事會 公鑒：

聯茂電子股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達聯茂電子股份有限公司民國九十年及八十九年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十年度及八十九年度之經營成果及現金流量。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號  
簽證文號

民國九十一年三月五日  
(附註十八所述事項之日期  
為民國九十一年四月三日)

聯茂電子股份有限公司

資產負債表

民國九十年及八十九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	90.12.31		89.12.31			負債及股東權益	90.12.31		89.12.31	
	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%
<b>流動資產：</b>						<b>流動負債：</b>				
1100 現金及銀行存款	\$ 59,683	3	154,834	8	21xx	短期借款(附註七及十五)	\$ 337,409	18	384,567	19
1120 應收票據(附註三)	34,786	2	39,928	2	2100	應付商業本票(附註八)	-	-	29,813	1
1130 應收票據—關係人(附註三及十四)	27,053	1	14,441	1	2111	一年內到期之長期借款(附註九及十五)	100,983	6	62,441	3
1140 應收帳款—減除備抵壞帳90年及89年皆為 2,647千元後之淨額(附註三及十五)	247,286	14	297,359	15	2272	應付票據(附註十四)	83,261	5	103,340	5
1150 應收帳款—關係人(附註十四)	22,617	1	26,354	1	2140	應付帳款(附註十四)	124,807	7	193,116	10
1210 存 貨(附註四)	123,318	7	156,416	8	2170	應付費用(附註十四)	48,853	3	82,751	4
1291 受限制存款(附註十五)	39,600	2	69,780	4	2224	應付設備工程款(附註十四)	13,922	1	95,706	5
1280 其他流動資產(附註三、十一、十四及十 五)	70,299	4	66,975	3	2280	其他流動負債(附註十一)	3,143	-	2,894	-
	<u>624,642</u>	<u>34</u>	<u>826,087</u>	<u>42</u>	2420	流動負債合計	<u>712,378</u>	<u>40</u>	<u>954,628</u>	<u>47</u>
1420 長期股權投資(附註五)	51,927	3	46,005	2	2420	長期借款已減除一年內到期部分(附註九及 十五)	322,463	18	411,109	21
15xx 固定資產淨額(附註六、十四、十五及 十六)：					2880	其他負債(附註五)	3,790	-	-	-
成 本：						負債合計	<u>1,038,631</u>	<u>58</u>	<u>1,365,737</u>	<u>68</u>
1501 土 地	240,356	13	240,356	12	3110	股東權益(附註五及十)：				
1521 房屋及建築物	214,519	13	209,823	11		股本—額定股本90年及89年分別為 740,000千元及700,000千元，每股面 額10元，90年及89年發行股數分別為 71,144千股及45,000千股	711,440	38	450,000	22
1531 機器設備	585,462	32	404,882	20	3141	預收股款	-	-	29,544	1
1551 營業設備	14,185	1	14,185	1	3150	增資準備	-	-	74,500	4
1681 雜項設備	117,098	6	102,401	5		資本公積iG	71,010	4	33,500	2
小 計	1,171,620	65	971,647	49		股本溢價				
15x9 減：累積折舊	137,748	8	72,865	4		保留盈餘iG				
1670 預付設備款及未完工程	38,446	2	187,218	9		法定盈餘公積	15,991	1	4,902	-
	<u>1,072,318</u>	<u>59</u>	<u>1,086,000</u>	<u>54</u>		3351 累積盈餘	<u>57,605</u>	<u>3</u>	<u>111,100</u>	<u>6</u>
1800 其他資產(附註十一、十二、十四及 十五)	79,845	4	41,438	2		權益調整iG	<u>73,596</u>	<u>4</u>	<u>116,002</u>	<u>6</u>
					3410	未實現長期股權投資跌價損失	(65,618)	(4)	(69,753)	(3)
					3240	累積換算調整數	(327)	-	-	-
							<u>(65,945)</u>	<u>(4)</u>	<u>(69,753)</u>	<u>(3)</u>
						股東權益合計	790,101	42	633,793	32
資產總計	<u>\$ 1,828,732</u>	<u>100</u>	<u>1,999,530</u>	<u>100</u>		承諾及或有負債(附註三、十四及十六)				
						負債及股東權益總計	<u>\$ 1,828,732</u>	<u>100</u>	<u>1,999,530</u>	<u>100</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司

損益表

民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	90 年度		89 年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註十四)	\$ 1,375,538	102	1,273,920	103
4171 減：銷貨退回	1,218	-	613	-
4191 銷貨折讓	27,747	2	35,495	3
4100 銷貨收入淨額	1,346,573	100	1,237,812	100
5111 銷貨成本(附註十四)	1,128,460	84	1,031,282	83
5910 銷貨毛利	218,113	16	206,530	17
6000 營業費用(附註三及十四)：				
6100 推銷費用	84,292	6	78,727	6
6200 管理及總務費用	43,872	3	50,124	4
6300 研究發展費用	25,195	2	12,148	1
	153,359	11	140,999	11
6900 營業淨利	64,754	5	65,531	6
7100 營業外收入：				
7110 利息收入	2,694	-	1,735	-
7120 投資收益(附註五)	-	-	20,099	2
7141 處分長短期投資利益	116	-	2,799	-
7161 兌換利益淨額	8,657	1	8,212	1
7481 其他收入	24,098	2	12,128	1
	35,564	3	44,973	4
7500 營業外支出：				
7511 利息支出(附註六)	54,206	4	32,852	3
7521 投資損失(附註五)	5,035	-	4,100	-
7531 處分固定資產損失	59	-	59	-
7551 存貨盤損淨額	2,550	-	1,503	-
7570 存貨跌價損失	98	-	2,787	-
7881 其他支出(附註十七)	8,333	1	35,621	3
	70,281	5	76,922	6
稅前淨利	30,037	3	33,582	4
8110 所得稅利益(附註十一)	(4,009)	-	(77,310)	(6)
9600 本期淨利	\$ 34,046	3	110,892	10
9700 普通股每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 0.50		1.87	

負責人：

經理人：

主辦會計：



聯茂電子股份有限公司

股東權益變動表

民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股 本	預收股款	增資準備	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘	長期投資未 實現跌價損失	累積換算 調 整 數	合 計
八十九年一月一日餘額	\$ 450,000	-	-	65,000	-	49,022	(16,027)	-	547,995
盈餘指撥及分配(附註十)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	4,902	(4,902)	-	-	-
股東紅利轉增資	-	-	13,500	-	-	(13,500)	-	-	-
員工紅利轉增資	-	-	29,500	-	-	(29,530)	-	-	(30)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(882)	-	-	(882)
資本公積轉增資(附註十)	-	-	31,500	(31,500)	-	-	-	-	-
預收股款(附註十)	-	29,544	-	-	-	-	-	-	29,544
長期投資未實現跌價損失(附註五)	-	-	-	-	-	-	(53,726)	-	(53,726)
八十九年度淨利	-	-	-	-	-	110,892	-	-	110,892
八十九年十二月三十一日餘額	450,000	29,544	74,500	33,500	4,902	111,100	(69,753)	-	633,793
增資準備轉增資(附註十)	74,500	-	(74,500)	-	-	-	-	-	-
現金增資(附註十)	100,000	(29,544)	-	50,000	-	-	-	-	120,456
盈餘指撥及分配(附註十)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	11,089	(11,089)	-	-	-
股東紅利	62,450	-	-	-	-	(62,450)	-	-	-
員工紅利	12,000	-	-	-	-	(12,001)	-	-	(1)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(2,001)	-	-	(2,001)
資本公積轉增資(附註十)	12,490	-	-	(12,490)	-	-	-	-	-
長期投資未實現跌價損失回升利益(附註五)	-	-	-	-	-	-	4,135	-	4,135
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(327)	(327)
九十年年度淨利	-	-	-	-	-	34,046	-	-	34,046
九十年十二月三十一日餘額	\$ 711,440	-	-	71,010	15,991	57,605	(65,618)	(327)	790,101

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司

現金流量表

民國九十年及八十九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	90 年度	89 年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利	\$ 34,046	110,892
調整項目：		
折舊費用及各項攤提	66,011	41,360
固定資產轉列費用	84	536
備抵壞帳及銷貨折讓迴轉	-	(3,107)
存貨及固定資產火災毀損淨額	-	(11,082)
處分固定資產損失	59	59
權益法認列之投資損失(利益)淨額	5,035	(20,099)
出售長、短期投資利益	(116)	(2,799)
存貨保險理賠款現金收入數	-	42,720
未實現兌換損失(利益)	(2,836)	317
投資損失	-	4,100
存貨跌價損失	98	2,787
應收票據(含關係人)增加	(7,470)	(3,395)
應收帳款(含關係人)減少(增加)	56,115	(72,684)
存貨減少(增加)	33,000	(117,713)
其他流動資產增加	(32,427)	(11,208)
遞延所得稅資產增加	(4,359)	(79,274)
應付票據減少	(20,079)	(26,292)
應付帳款增加(減少)	(68,309)	98,666
應付費用增加(減少)	(33,898)	41,608
其他流動負債減少	(1,753)	(339)
預付退休金增加	(119)	(520)
<b>營業活動之淨現金流入(出)</b>	<b>23,082</b>	<b>(5,467)</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
短期投資淨變動數	116	324
購買長期投資	(3,359)	(3,335)
出售長期投資價款	-	9,332
受限制銀行存款減少(增加)	30,160	(59,009)
購置固定資產	(137,368)	(613,047)
固定資產保險理賠款現金收入數	-	313,280
出售固定資產價款	9	9
其他資產減少(增加)	(1,495)	568
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(111,937)</b>	<b>(351,878)</b>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款增加(減少)	(46,835)	253,060
應付商業本票增加(減少)	(29,813)	129
長期借款增加	12,337	236,884
償還長期借款	(62,441)	(61,073)
預收股款增加	-	29,544
發行普通股價款	120,456	-
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>(6,296)</b>	<b>458,544</b>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	(95,151)	101,199
期初現金及銀行存款餘額	154,834	53,635
期末現金及銀行存款餘額	<b>\$ 59,683</b>	<b>154,834</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 54,780	30,406
本期支付所得稅	\$ 2,118	29
<b>不影響現金流量之投資及理財活動：</b>		
長期借款一年內到期部分	\$ 100,983	62,441
長期投資未實現跌價損失(回升利益)	\$ (4,135)	53,726
應付董監事酬勞及員工紅利增加	\$ 2,002	-
固定資產轉列其他資產	\$ 4,015	-
<b>購入固定資產總額與現金支付數之調節：</b>		
固定資產增加總額	\$ 55,584	694,411
應付設備款減少(增加)	81,784	(81,364)
購買固定資產現金支付數	<b>\$ 137,368</b>	<b>613,047</b>

負責人：

經理人：

主辦會計：

## 聯茂電子股份有限公司財務報表會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司董事會 公鑒：

聯茂電子股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之資產負債表，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述之財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達聯茂電子股份有限公司民國九十一年及九十年十二月三十一日之財務狀況，暨截至各該日止之民國九十一年度及九十年之經營成果及現金流量。

聯茂電子股份有限公司已編製民國九十一年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號  
簽證文號

民 國 九 十 二 年 三 月 十 日



聯茂電子股份有限公司

損益表

民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	91年度		90年度	
	金額	%	金額	%
4110 銷貨收入(附註十五)	\$ 1,775,130	103	1,375,538	102
4171 減：銷貨退回	20,603	1	1,218	-
4191 銷貨折讓	41,240	2	27,747	2
4100 銷貨收入淨額	1,713,287	100	1,346,573	100
5111 銷貨成本(附註十三及十五)	1,341,805	78	1,128,460	84
5910 營業毛利	371,482	22	218,113	16
6000 營業費用(附註四、十三及十五)：				
6100 推銷費用	128,015	7	84,292	6
6200 管理及總務費用	55,026	3	43,872	3
6300 研究發展費用	42,088	2	25,195	2
	225,129	12	153,359	11
6900 營業淨利	146,353	10	64,754	5
7100 營業外收入：				
7110 利息收入	1,582	-	2,693	-
7141 處分長短期投資利益	10	-	116	-
7151 存貨盤盈淨額	1,279	-	-	-
7161 兌換利益淨額	-	-	8,657	1
7481 其他收入(附註十五)	28,496	2	24,098	2
	31,367	2	35,564	3
營業外支出：				
7511 利息支出(附註七)	50,060	3	54,206	4
7521 投資損失(附註六)	16,313	1	5,035	-
7531 處分固定資產損失	-	-	59	-
7551 存貨盤損淨額	-	-	2,550	-
7561 兌換損失淨額	15	-	-	-
7570 存貨跌價損失	65	-	98	-
7881 其他支出	8,972	1	8,333	1
	75,425	5	70,281	5
本期稅前淨利	102,295	7	30,037	3
8110 所得稅費用(利益)(附註十二)	20,602	1	(4,009)	-
本期淨利(附註三)	\$ 81,693	6	34,046	3

	稅前	稅後	稅前	稅後
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.29	1.03	0.44	0.50

假設子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：

	稅前	稅後
本期淨利	\$ 101,965	81,363
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	\$ 1.28	1.02

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司

股東權益變動表

民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	預收股款	增資準備	資本公積	法定盈餘公積	累積盈餘	長期投資未實現跌價損失	累積換算調整數	合計
九十年一月一日期初餘額	\$ 450,000	29,544	74,500	33,500	4,902	111,100	(69,753)	-	633,793
增資準備轉增資(附註十一)	74,500	-	(74,500)	-	-	-	-	-	-
現金增資(附註十一)	100,000	(29,544)	-	50,000	-	-	-	-	120,456
盈餘指撥及分配(附註十一)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	11,089	(11,089)	-	-	-
股東紅利	62,450	-	-	-	-	(62,450)	-	-	-
員工紅利	12,000	-	-	-	-	(12,001)	-	-	(1)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(2,001)	-	-	(2,001)
資本公積轉增資(附註十一)	12,490	-	-	(12,490)	-	-	-	-	-
長期投資未實現跌價損失回升(附註六)	-	-	-	-	-	-	4,135	-	4,135
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(327)	(327)
九十年年度淨利	-	-	-	-	-	34,046	-	-	34,046
九十年十二月三十一日餘額	711,440	-	-	71,010	15,991	57,605	(65,618)	(327)	790,101
現金增資(附註十一)	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
盈餘指撥及分配(附註十一)：									
提列法定盈餘公積	-	-	-	-	3,405	(3,405)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	-	-	(4,336)	-	-	(4,336)
董監事酬勞	-	-	-	-	-	(1,084)	-	-	(1,084)
長期投資未實現跌價損失回升(附註六)	-	-	-	-	-	-	3,862	-	3,862
換算調整數	-	-	-	-	-	-	-	(288)	(288)
子公司出售庫藏股調整數(附註三及六)	-	-	-	-	-	(330)	-	-	(330)
九十一年度淨利	-	-	-	-	-	81,693	-	-	81,693
九十一年十二月三十一日餘額	\$ 811,440	-	-	71,010	19,396	130,143	(61,756)	(615)	969,618

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司

現金流量表

民國九十一年及九十年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	91 年度	90 年度
<b>營業活動之現金流量：</b>		
本期淨利	\$ 81,693	34,046
調整項目：		
折舊費用及各項攤提	74,506	66,011
備抵壞帳及銷貨折讓提列	4,985	-
固定資產轉列費用	-	84
處分固定資產損失	-	59
投資損失	3,885	-
權益法認列之投資損失淨額	12,428	5,035
出售長、短期投資利益	(10)	(116)
未實現兌換利益	(4,145)	(2,836)
存貨跌價損失	65	98
應收票據(含關係人)增加	(64,682)	(7,470)
應收帳款(含關係人)減少(增加)	(193,058)	56,115
存貨減少(增加)	(75,725)	33,000
其他應收款－關係人增加	(16,809)	-
其他流動資產減少(增加)	2,220	(28,041)
遞延所得稅資產負債淨變動數	20,603	(4,359)
應付票據增加(減少)	151,053	(20,079)
應付帳款增加(減少)	65,599	(68,309)
應付費用減少	(3,152)	(33,898)
其他流動負債增加(減少)	1,348	(1,753)
預付退休金減少(增加)	568	(119)
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>61,372</b>	<b>27,468</b>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
短期投資淨變動數	10	116
購買長期投資	(128,189)	(3,359)
受限制銀行存款減少(增加)	(50,004)	30,160
購置固定資產	(66,004)	(137,368)
出售固定資產價款	-	9
其他應收款－關係人增加	(35,017)	(4,386)
其他資產增加	(2,113)	(1,495)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(281,317)</b>	<b>(116,323)</b>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
短期借款減少	(56,108)	(46,835)
應付商業本票增加(減少)	9,924	(29,813)
長期借款增加	640,552	12,337
償還長期借款	(414,581)	(62,441)
發行普通股價款	100,000	120,456
發放董監事酬勞及員工紅利	(8,154)	-
<b>融資活動之淨現金流入(出)</b>	<b>271,633</b>	<b>(6,296)</b>
<b>本期現金及銀行存款增加(減少)數</b>	<b>51,688</b>	<b>(95,151)</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>59,683</b>	<b>154,834</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>\$ 111,371</b>	<b>\$ 59,683</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息(不含資本化利息)	<b>\$ 50,724</b>	<b>\$ 54,780</b>
本期支付所得稅	<b>\$ 3,381</b>	<b>\$ 2,118</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
長期借款一年內到期部分	<b>\$ 28,882</b>	<b>\$ 100,983</b>
長期投資未實現跌價損失回升	<b>\$ (3,862)</b>	<b>\$ (4,135)</b>
固定資產轉列其他資產	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,015</b>
外幣長期股權之換算調整數	<b>\$ (288)</b>	<b>\$ (327)</b>
<b>購入固定資產總額與現金支付數之調節：</b>		
固定資產增加總額	\$ 61,882	55,584
應付設備款減少	5,591	81,784
應付租賃款增加	(1,469)	-
購買固定資產現金支付數	<b>\$ 66,004</b>	<b>\$ 137,368</b>
<b>董監酬勞及員工紅利支付數：</b>		
董監酬勞及員工紅利分配數	\$ 5,420	2,001
應付董監酬勞及員工紅利減少(增加)	2,734	(2,001)
	<b>\$ 8,154</b>	<b>\$ -</b>
<b>出售固定資產現金收取數：</b>		
出售固定資產價款	\$ 39,539	9
應收出售財產價款增加(列入其他應收款－關係人)	(39,539)	-
合計	-	9
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

負責人：

經理人：

主辦會計：

## 聯茂電子股份有限公司及其子公司合併財務報表會計師查核報告

聯茂電子股份有限公司董事會 公鑒：

聯茂電子股份有限公司及其子公司(以下合稱合併公司)民國九十一年十二月三十一日之合併資產負債表，暨截至該日止之民國九十一年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照我國一般公認審計準則暨會計師查核簽證財務報表規則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨我國一般公認會計原則編製，足以允當表達合併公司民國九十一年十二月三十一日之合併財務狀況，暨截至該日止之民國九十一年度之合併經營成果及合併現金流量。

安 侯 建 業 會 計 師 事 務 所

會 計 師：

證期會核准：(88)台財證(六)第18311號  
簽證文號

民 國 九 十 二 年 三 月 十 日



聯茂電子股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國九十一年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產	金 額	%		負債及股東權益	金 額	%
11xx 流動資產：				21xx 流動負債：		
1100 現金及銀行存款	\$ 123,936	4		2100 短期借款(附註七及十六)	\$ 281,549	11
1120 應收票據(附註十六)	84,537	3		2111 應付商業本票(附註八及十六)	9,924	-
1130 應收票據－關係人(附註十五)	41,984	2		2272 一年內到期之長期借款(附註十及十六)	28,882	1
1140 應收帳款－減除備抵壞帳及備抵銷貨折讓7,632千元後之淨額(附註三)	409,190	16		2120 應付票據	234,314	9
1150 應收帳款－關係人(附註十五)	52,970	2		2140 應付帳款	202,138	8
1210 存 貨(附註四)	229,366	9		2170 應付費用	45,701	2
1291 受限制存款(附註十六)	89,590	4		2224 應付設備工程款(附註九)	48,460	2
1280 其他流動資產(附註三、十二、十四及十五)	<u>78,420</u>	<u>3</u>		2280 其他流動負債(附註六)	<u>8,756</u>	<u>-</u>
	<u>1,109,993</u>	<u>43</u>		流動負債合計	<u>859,724</u>	<u>33</u>
1420 長期股權投資(附註五)	<u>52,590</u>	<u>2</u>		2420 長期借款已減除一年內到期部分(附註十及十六)	<u>620,535</u>	<u>24</u>
15xx 固定資產淨額(附註六、十六及十七)：				其他負債：		
成 本：				2880 其他負債(附註五及六)	1,399	-
1501 土 地	253,716	10		2883 少數股權	<u>100,124</u>	<u>4</u>
1521 房屋及建築物	220,311	9		其他負債合計	<u>101,523</u>	<u>4</u>
1531 機器設備	591,760	23		負債合計	<u>1,581,782</u>	<u>61</u>
1551 營業設備	15,638	1		3xxx 股東權益(附註五及十一)：		
1611 租賃資產	2,657	-		3110 股本－額定股本為1,000,000千元，每股面額10元，發行股數為81,144千股	811,440	32
1681 雜項設備	<u>123,293</u>	<u>5</u>		32xx 資本公積;G		
小 計	1,207,375	48		3210 股本溢價	71,010	3
15x9 減：累積折舊	206,406	8		33xx 保留盈餘;G		
1670 預付設備款及未完工程	<u>303,529</u>	<u>12</u>		3310 法定盈餘公積	19,396	1
	<u>1,304,498</u>	<u>52</u>		3351 累積盈餘	<u>130,143</u>	<u>5</u>
1800 其他資產(附註十二、十三及十六)	84,319	3			<u>149,539</u>	<u>6</u>
				34xx 股東權益其他調整項目：		
				3410 未實現長期股權投資跌價損失	(61,756)	(2)
				3240 累積換算調整數	<u>(615)</u>	<u>-</u>
					<u>(62,371)</u>	<u>(2)</u>
資產總計	<u>\$ 2,551,400</u>	<u>100</u>		股東權益合計	<u>969,618</u>	<u>39</u>
				承諾及或有負債(附註十七)		
				負債及股東權益總計	<u>\$ 2,551,400</u>	<u>100</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司及其子公司

合併損益表

民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	<u>金</u>	<u>額</u>	<u>%</u>
4110 銷貨收入(附註十五)	\$	1,775,058	104
4171 減：銷貨退回		20,603	1
4191 銷貨折讓		<u>41,240</u>	<u>3</u>
4100 銷貨收入淨額		1,713,215	100
5111 銷貨成本(附註十三)		<u>1,340,015</u>	<u>78</u>
5910 營業毛利		373,200	22
6000 營業費用(附註三、十三及十五)：			
6100 推銷費用		128,193	7
6200 管理及總務費用		79,539	5
6300 研究發展費用		<u>42,088</u>	<u>2</u>
		<u>249,820</u>	<u>14</u>
6900 營業淨利		<u>123,380</u>	<u>8</u>
7100 營業外收入：			
7110 利息收入		1,814	-
7141 處分長短期投資利益		10	-
7151 存貨盤盈淨額		1,279	-
7481 其他收入		<u>38,669</u>	<u>2</u>
		<u>41,772</u>	<u>2</u>
7500 營業外支出：			
7511 利息支出(附註六)		50,507	3
7521 投資損失(附註五)		5,896	-
7561 兌換損失淨額		15	-
7570 存貨跌價損失		392	-
7881 其他支出		<u>9,175</u>	<u>1</u>
		<u>65,985</u>	<u>4</u>
7900 本期稅前淨利		99,167	6
8110 所得稅費用(附註十二)		<u>20,602</u>	<u>1</u>
8900 綜合淨利		78,565	5
9400 少數股權淨損		<u>3,128</u>	<u>-</u>
9600 合併淨利	<b>\$</b>	<b><u>81,693</u></b>	<b><u>5</u></b>

	<u>稅前</u>	<u>稅後</u>
9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<b>\$ <u>1.29</u></b>	<b><u>1.03</u></b>

假設子公司持有本公司股票不視為庫藏股票時之擬制資料：

	<u>稅前</u>	<u>稅後</u>
本期淨利	<b>\$ <u>101,965</u></b>	<b><u>81,363</u></b>
基本每股盈餘(單位：新台幣元)	<b>\$ <u>1.28</u></b>	<b><u>1.02</u></b>

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	資本公積	法定盈 餘公積	累積盈餘	長期投資未 實現跌價損失	累積換算 調整數	合計
九十一年一月一日期初餘額	\$ 711,440	71,010	15,991	57,605	(65,618)	(327)	790,101
現金增資(附註十一)	100,000	-	-	-	-	-	100,000
盈餘指撥及分配(附註十一)：							
提列法定盈餘公積	-	-	3,405	(3,405)	-	-	-
員工紅利	-	-	-	(4,336)	-	-	(4,336)
董監事酬勞	-	-	-	(1,084)	-	-	(1,084)
長期投資未實現跌價損失回升(附註五)	-	-	-	-	3,862	-	3,862
換算調整數	-	-	-	-	-	(288)	(288)
子公司出售庫藏股調整數(附註五)	-	-	-	(330)	-	-	(330)
九十一年度淨利	-	-	-	81,693	-	-	81,693
九十一年十二月三十一日餘額	<u>\$ 811,440</u>	<u>71,010</u>	<u>19,396</u>	<u>130,143</u>	<u>(61,756)</u>	<u>(615)</u>	<u>969,618</u>

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司及其子公司  
合併現金流量表  
民國九十一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期淨利	\$ 81,693
調整項目：	
少數股權淨損	(3,128)
折舊費用及各項攤提	74,571
備抵壞帳及銷貨折讓提列	4,985
投資損失	3,885
權益法認列之投資損失淨額	2,011
出售長、短期投資利益	(10)
未實現兌換利益	(4,145)
存貨跌價損失	392
應收票據(含關係人)增加	(64,682)
應收帳款(含關係人)增加	(193,058)
存貨增加	(106,440)
其他流動資產減少	743
遞延所得稅資產負債淨變動數	20,603
應付票據增加	151,053
應付帳款增加	77,411
應付費用減少	(3,152)
其他流動負債增加	6,994
預付退休金減少	568
<b>營業活動之淨現金流入</b>	<b>50,294</b>

投資活動之現金流量：

短期投資淨變動數	10
購買長期投資	(3,458)
受限制銀行存款增加	(50,004)
購置固定資產	(266,143)
其他應收款－關係人增加	(1,127)
其他資產增加	(36,733)
<b>投資活動之淨現金流出</b>	<b>(357,455)</b>

融資活動之現金流量：

短期借款減少	(56,108)
應付商業本票增加	9,924
長期借款增加	640,552
償還長期借款	(438,778)
發行普通股價款	100,000
發放董監事酬勞及員工紅利	(8,154)
少數股權增加	103,252
<b>融資活動之淨現金流入</b>	<b>350,688</b>

匯率影響數

	(3,529)
--	---------

本期現金及銀行存款增加數

	39,998
--	--------

期初現金及銀行存款餘額

	83,938
--	--------

期末現金及銀行存款餘額

	<b>\$ 123,936</b>
--	-------------------

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息(不含資本化利息)	<b>\$ 51,171</b>
-----------------	------------------

本期支付所得稅	<b>\$ 3,381</b>
---------	-----------------

不影響現金流量之投資及融資活動：

長期借款一年內到期部分	<b>\$ 28,882</b>
-------------	------------------

長期投資未實現跌價損失回升	<b>\$ (3,862)</b>
---------------	-------------------

外幣長期股權之換算調整數	<b>\$ 288</b>
--------------	---------------

購入固定資產總額與現金支付數之調節：

固定資產增加總額	\$ 302,150
----------	------------

應付設備款增加	(34,538)
---------	----------

應付租賃款增加	(1,469)
---------	---------

購買固定資產現金支付數	<b>\$ 266,143</b>
-------------	-------------------

董監酬勞及員工紅利支付數：

董監酬勞及員工紅利分配數	\$ 5,420
--------------	----------

應付董監酬勞及員工紅利減少	2,734
---------------	-------

	<b>\$ 8,154</b>
--	-----------------

負責人：

經理人：

主辦會計：

聯茂電子股份有限公司申報案件檢查表

會計師複核彙總意見

聯茂電子股份有限公司本次為募集與發行第一次有擔保公司債（發行總額新台幣壹億元；每張面額新台幣壹百萬元，共壹百張），向財政部證券暨期貨管理委員會提出申報，業依規定填報案件檢查表，並經本會計師採取必要程序予以複核，特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本複核意見。

依本會計師意見，聯茂電子股份有限公司本次向財政部證券暨期貨管理委員會提出之案件檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響募集與發行第一次有擔保公司債之情事。

此致

聯茂電子股份有限公司

安侯建業會計師事務所

會計師：

中華民國 九十二年 六月 九 日

附件一、毛利率變化之價量分析

單位：仟平方英尺；新台幣仟元

年度	產品別	分析項目	差	異	說明	
91年	玻璃纖維膠片	1.收入差異分析	1.收入差異分析		91年雖因同業競爭激烈，產品售價下跌，惟因積極爭取訂單致銷售量明顯上升，加以單位成本降低，毛利因而增加。	
		P(Q'-Q)	$5.35329 \times (70,872 - 65,125)$	=		30,765
		Q(P'-P)	$65,125 \times (4.59802 - 5.35329)$	=		(49,187)
		(P'-P)(Q'-Q)	$(4.59802 - 5.35329) \times (70,872 - 65,125)$	=		(4,341)
		P'Q'-PQ	$4.59802 \times 70,872 - 5.35329 \times 65,125$	=		(22,762)
		2.成本差異分析	2.成本差異分析			
		P(Q'-Q)	$4.32685 \times (70,872 - 65,125)$	=		299,533
		Q(P'-P)	$65,125 \times (3.56972 - 4.32685)$	=		(89,552)
		(P'-P)(Q'-Q)	$(3.56972 - 4.32685) \times (70,872 - 65,125)$	=		(61,390)
		P'Q'-PQ	$3.56972 \times 70,872 - 4.32685 \times 65,125$	=		148,591
		3.尾數差異影響數	3.尾數差異影響數			0
		4.毛利變動金額	4.毛利變動金額			6,031
		銅箔基板	1.收入差異分析	1.收入差異分析		91年度因成功開發新客戶及推出新產品，銷售量大增，產生有利之收入數量差異，加以規模經濟效益發揮，單位成本下降，毛利遂增加。
	P(Q'-Q)		$31.83636 \times (25,082 - 15,308)$	=	311,169	
	Q(P'-P)		$15,308 \times (27.34311 - 31.83636)$	=	(68,783)	
	(P'-P)(Q'-Q)		$(27.34311 - 31.83636) \times (25,082 - 15,308)$	=	(43,917)	
	P'Q'-PQ		$27.34311 \times 25,082 - 31.83636 \times 15,308$	=	198,469	
	2.成本差異分析		2.成本差異分析			
	P(Q'-Q)		$28.54331 \times (25,082 - 15,308)$	=	278,982	
Q(P'-P)	$15,308 \times (22.69329 - 28.54331)$		=	(89,552)		
(P'-P)(Q'-Q)	$(22.69329 - 28.54331) \times (25,082 - 15,308)$		=	(57,178)		
P'Q'-PQ	$22.69329 \times 25,082 - 28.54331 \times 15,308$		=	132,252		
3.尾數差異影響數	3.尾數差異影響數		0			
4.毛利變動金額	4.毛利變動金額		66,217			
多層壓合基板	1.收入差異分析		1.收入差異分析		受惠於銷量增加，及產能利用率提高，單位成本下降，毛利因而上增。	
	P(Q'-Q)	$165.88592 \times (4,674 - 3,068)$	=	266,413		
	Q(P'-P)	$3,068 \times (149.38425 - 165.88592)$	=	(50,627)		
	(P'-P)(Q'-Q)	$(149.38425 - 165.88592) \times (4,674 - 3,068)$	=	(26,502)		
	P'Q'-PQ	$149.38425 \times 4,674 - 165.88592 \times 3,068$	=	189,284		
	2.成本差異分析	2.成本差異分析				
	P(Q'-Q)	$133.55052 \times (4,674 - 3,068)$	=	214,482		
	Q(P'-P)	$3,068 \times (110.79290 - 133.55052)$	=	(69,820)		
	(P'-P)(Q'-Q)	$(110.79290 - 133.55052) \times (4,674 - 3,068)$	=	(36,549)		
	P'Q'-PQ	$110.79290 \times 4,674 - 133.55052 \times 3,068$	=	108,113		
	3.尾數差異影響數	3.尾數差異影響數		0		
	4.毛利變動金額	4.毛利變動金額		81,171		
	其他	90年營業毛利				1,651
91年營業毛利				1,601		
差異				(50)		

註：其他包括出售原物料及運費收入，故無法分析價量變化

註1：P'、Q'為當年度之單價、數量；P、Q為上年度之單價、數量

聯茂電子股份有限公司

董 事 長：萬海威

董事兼總經理：高繼祖

董 事：白蓉生

董 事：黃琇卿

董 事：徐超俊

董 事：寶聚投資(股)公司(代表人：楊玉霞)

總 經 理：高繼祖